

Restorative Manual

3i インプラント 補綴マニュアル

Flexibility By Design



製品に関する重要な情報

Biomet 3i 補綴製品

全ての Biomet 3i 補綴製品の詳細な情報は ifu.biomet3i.com にある Biomet 3i Restorative Products IFU (P-IIS086GR) もしくは製品付属の添付文書をご覧ください。

アイコン:

サーテン・インターナル・コネクション	
エクスターナル・コネクション	
サーテン・インターナル・コネクション およびエクスターナル・コネクション	

アイコンの見方

アイコンは BIOMET 3i インプラント、アバットメントの接合様式を表しており、サーテン・インターナル・コネクションとエクスターナル・コネクションを示しています。

承認番号: 20500BZG00021000/20500BZG00022000/20500BZG00023000/21000BZG00056000/21800BZG10016000/21800BZG10017000/21800BZG10022000/
21900BZG00001000/22000BZIO0002000/22100BZIO0014000/22200BZIO0005000/22200BZIO0011000/22200BZIO0018000/22400BZX00181000/
22400BZX00182000/22500BZX00234000/22600BZX00131000/22600BZX00290000/22600BZX00397000/22600BZX00467000/22600BZX00468000/
22600BZX00470000/22900BZX00112000/21100BZY00280000/22400BZX00002000/23100BZX00011000/20700BZG00024000/30500BZX00023000

認証番号: 230ALBZX00004000/226ALBZX00018000

届出番号: 13B1X00079000075/13B1X00079000076/13B1X00079000077/13B1X00079000078/13B1X00079000079/13B1X00079000080/13B1X00079000081/
13B1X00079000082/13B1X00079000083/13B1X00079000084/13B1X00079000085/13B1X00079000086/13B1X00079000087/13B1X00079000088/
13B1X00079000089/13B1X00079000090/13B1X00079000091/13B1X00079000092/13B1X00079000093/13B1X00079000094/13B1X00079000095/
13B1X00079000096/13B1X00079000097/13B1X00079000098/13B1X00079000099/13B1X00079000100/13B1X00079000101/13B1X00079000103/
13B1X00079000104/13B1X00079000105/13B1X00079000106/13B1X00079000107/13B1X00079000108/13B1X00079000109/13B1X00079000111/
13B1X00079000112/13B1X00079000113/13B1X00079000114/13B1X00079000115/13B1X00079000116/13B1X00079000117/13B1X00079000118/
13B1X00079000119/13B1X00079000120/13B1X00079000121/13B1X00079000122/13B1X00079000123/13B1X00079000124/13B1X00079000125/
13B1X00079000126/13B1X00079000127/13B1X00079000128/13B1X00079000129/13B1X00079000130/13B1X00079000131/13B1X00079000132/
13B1X00079000133/13B1X00079000134/13B1X00079000135/13B1X00079000136/13B1X00079000137/13B1X00079000138/13B1X00079000139/
13B1X00079000140/13B1X00079000141/13B1X00079000142/13B1X00079000143/27B1X00020229005/27B1X00109000319

イントロダクション

BIOMET 3i インプラント・システムは、多様化する患者ニーズに対して、また各歯科医師のそれぞれの臨床的ニーズを満たすための外科および補綴技術の選択肢を提供するために開発されました。本マニュアルは歯科医師の方々に BIOMET 3i の補綴コンポーネントおよび器具を最大限活用いただくために作成しています。歯科インプラントおよびアバットメント・システムの成功のためには、コンポーネントならびに器具類を正しく使用しなければなりません。

本マニュアルは専門的な教育および経験の代わりになるものではなく、また臨床的なアドバイスを含むものでもありません。予知性の高い治療のために、歯科医師は医学的見地に基いた治療計画を立て、術式を選択しなければなりません。

BIOMET 3i は、単独クラウン、ブリッジ、固定式/可撤式補綴物、オーバーデンチャーを支えるアタッチメントなど、歯科医師に幅広い補綴ソリューションを提供するため、独自のインプラントおよび補綴コンポーネントを用意しています。BIOMET 3i インプラントおよびアバットメントには、実績豊富な補綴デザインを採用し、歯科医師と患者に予知性の高い治療の選択肢を提供します。

治療計画：

患者の評価と選択

インプラント治療に先立つ患者評価に関しては、幾つかの考慮すべき要素があります。術前評価には、健康状態の詳細な評価、既往症、病歴、口腔衛生状態、モチベーション、患者の治療に対する期待度などが含まれます。もし患者の病歴が治療を妨げたり、患者の健康状態を損なう可能性のある兆候を示唆した場合には、医師の診断を受けることを推奨します。

口腔内の検査を徹底して行い、潜在的な骨又は軟組織の病理があるかを評価します。また残存歯の歯周の状態や軟組織の健康状態、歯ぎしり、または交叉咬合といった咬合異常も見極める必要があります。インプラント治療に有害な影響を与えかねない他の条件の有無も調べなければなりません。

施術前計画の注意点：

施術前の補綴計画フェーズでは、歯科医、歯科技工士が、使用する補綴物および補綴コンポーネントを判断する必要があります。その上でインプラント埋入位置を決めるのが重要であり、これはインプラント埋入手術の前に決定されなければなりません。

インプラント埋入前に最終補綴物を設計し、インプラントの埋入位置の決定および、補綴コンポーネントを選択するという、トップダウン・トリートメント・プランニングのアプローチが推奨されます。

インプラントと補綴の長期にわたる成功のために、適切な治療計画を立てることは、インプラントサイズの選択と同様に重要です。インプラントサイズの選択の前に、インプラント埋入部位の解剖学的状態を入念に調べなければなりません。

適切な治療方法を決定するために、以下の臨床情報が必要となりますが、これらに限定されるものではありません。咬合高径の決定、使用予定のアバットメントと最終補綴物が装着できるだけのクリアランスが確保できるかどうかの見極め、重要な器官の解剖学的な位置の確認、インプラント埋入部位の骨量の計測。

補綴コンポーネントに必要な高さは、アバットメントの種類によって変わります。補綴に用いることができるスペースに合せ、アバットメントの形状、サイズを慎重に選択しなければなりません。

診断用模型を用いて、歯と顎堤の位置、咬合関係、インプラント補綴に必要なスペース、インプラントの埋入位置と角度を決定してください。このような模型を用いることで、対合歯列とインプラント体のポジションへの影響を見極めることができます。口腔内におけるインプラント体の位置、角度を正確に決定する上でサージカルガイドは有用であり、その使用を術前の治療計画で検討してください。

インプラント手術の前に、補綴物の最終設計を視覚的に確認することによって、補綴関連の潜在的な問題を特定することができます。それにより、実際にインプラントを埋入する前に、インプラントのサイズ選択、埋入位置、全体的な治療計画に対して、必要に応じた修正を加えることができ、治療の予知性と成功を向上させます。

目次

トルク・マトリックス

サーテン・インターナル・コネクション	1
エクスターナル・コネクション	2

インプラント/アバットメント・コネクション

サーテン・インターナル・コネクション	3
エクスターナル・コネクション	4
サーテン・クイックシート・アクチベイター・ツール	5
サーテン・ヘクスト/ノンヘクスト・ピックアップ・インプレッション・コーピング許容角度	6
サーテン・UCLA アバットメント	7
サーテン・ノンヘクスト・アバットメント	8

印象採得

コーピングの選択	9
ピックアップ・インプレッション・コーピング	10
ツイストロック・トランスファー・インプラント・インプレッション・コーピング	13
アバットメントの選択	16

セメント・リテイニング

プレフォーマンス・ポスト	間接法	18
プレフォーマンス・ポスト	直接法	20
15° プレフォーマンス・ポスト	間接法	21
15° プレフォーマンス・ポスト	直接法	23
ジンジヒュー・ポスト	間接法	24
ジンジヒュー・ポスト	直接法	26
UCLA アバットメント 単独歯	間接法	29
UCLA アバットメント 多数歯	間接法	31

スクリュー・リテイニング

プレフォーマンス・テンポラリー・シリンダー 単独歯	間接法	34
プレフォーマンス・テンポラリー・シリンダー 単独歯	直接法	36
プレフォーマンス・テンポラリー・シリンダー 多数歯	間接法	37
インプラント・テンポラリー・シリンダー 単独歯	間接法	39
インプラント・テンポラリー・シリンダー 多数歯	間接法	41
UCLA アバットメント 単独歯	間接法	43
UCLA アバットメント 多数歯	間接法	45
ロー・プロファイル・アバットメント 単独歯	間接法	47
ロー・プロファイル・アバットメント 多数歯	間接法	50

固定式補綴へのデンチャー コンバージョン

クイックブリッジ・プロビジョナル・コンポーネント	直接法	53
--------------------------	-----	----

固定式補綴のためのプロビジョナル作製

クイックブリッジ・プロビジョナル・レストレーション	間接法	55
---------------------------	-----	----

ボーン・アンカード・ブリッジ

UCLA アバットメント		57
ロー・プロファイル・アバットメント		60



トルク・マトリックス- サーテン・インターナル・コネクション

BIOMET 3i のスレッド付きデバイス（スクリュー、アバットメント等）で使用する
ドライバー類と推奨トルクの一覧

推奨トルク - インターナル・コネクション			
BIOMET 3i スレッド式デバイス	推奨トルク値	BIOMET 3i ドライバー	BIOMET 3i ドライバーチップ
トライイン・スクリュー	手締め	PHD02N ラージ・ヘクス・ドライバー 17mm (L)	該当なし
ワクシング・スクリュー		PHD03N ラージ・ヘクス・ドライバー 24mm (L)	
フラット・カバー・スクリュー	10Ncm	PHD02N ラージ・ヘクス・ドライバー 17mm (L) PHD03N ラージ・ヘクス・ドライバー 24mm (L)	RASH3N ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ 24mm (L) RASH8N ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ 30mm (L)
カバー・スクリュー			
ロー・プロファイル・アバットメント・リテイニング・スクリュー（ゴールド/チタン）			
ワンピース・ヒーリング・アバットメント	20Ncm	PHD02N ラージ・ヘクス・ドライバー 17mm (L) PHD03N ラージ・ヘクス・ドライバー 24mm (L)	RASH3N ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ 24mm (L) RASH8N ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ 30mm (L)
BellaTek Encode ヒーリング・アバットメント			
BellaTek Encode エマージェンス・ヒーリング・アバットメント			
ゴールドタイト/チタン・ヘクスト・ラージ・ダイアメーター・スクリュー			
サーテン・ゴールドタイト/チタン・ヘクスト・ユニスクリュー			
ロー・プロファイル・アバットメント	20Ncm	PAD00 アバットメント・ドライバー 17mm (L) PAD24 アバットメント・ドライバー 24mm (L)	RASA3 アバットメント・ドライバー・チップ



トルク・マトリックス- エクスターナル・コネクション

BIOMET 3i のスレッド付きデバイス（スクリュー、アバットメント等）で使用する
ドライバー類と推奨トルクの一覧

推奨トルク - エクスターナル・コネクション			
BIOMET 3i スレッド式デバイス	推奨トルク値	BIOMET 3i ドライバー	BIOMET 3i ドライバーチップ
インプラント・マウント	手締め	PHD02N ラージ・ヘクス・ドライバー 17mm (L)	該当なし
ワクシング・スクリュー		PHD03N ラージ・ヘクス・ドライバー 24mm (L)	
スクエア・トライイン・スクリュー	手締め	PSQD0N スクエア・ドライバー 17mm (L) PSQD1N スクエア・ドライバー 24mm (L)	該当なし
カバー・スクリュー	10Ncm	PHD00N スモール・ヘクス・ドライバー 17mm (L) PHD01N スモール・ヘクス・ドライバー 24mm (L)	RASH2N スモール・ヘクス・ドライバー・チップ 24mm (L) RASH7N スモール・ヘクス・ドライバー・チップ 30mm (L)
ワンピース・ヒーリング・アバットメント	20Ncm	PHD02N ラージ・ヘクス・ドライバー 17mm (L) PHD03N ラージ・ヘクス・ドライバー 24mm (L)	RASH3N ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ 24mm (L) RASH8N ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ 30mm (L)
BellaTek Encode ヒーリング・アバットメント			
ゴールドタイト/チタン・ヘクスト・ユニスクリュー			
ロー・プロファイル・アバットメント	20Ncm	PAD00 アバットメント・ドライバー 17mm (L) PAD24 アバットメント・ドライバー 24mm (L)	RASA3 アバットメント・ドライバー・チップ
ゴールドタイト/チタン・スクエア・ユニスクリュー	32 ~ 35Ncm	PSQD0N スクエア・ドライバー 17mm (L) PSQD1N スクエア・ドライバー 24mm (L)	RASQ3N スクエア・ドライバー・チップ 24mm (L) RASQ8N スクエア・ドライバー・チップ 30mm (L)

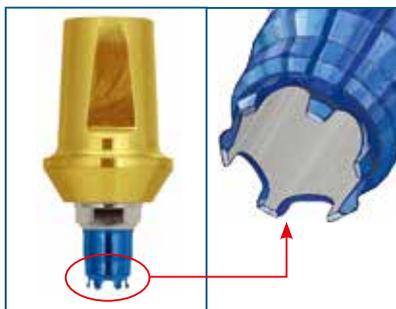
インプラント／アバットメント・コネクション



■ サーテン・インターナル・コネクション

使いやすさを追求したインターナル・コネクション・インプラント

- サーテン・インターナル・コネクションは、インプレッションコーピングやアバットメントの接続時に「カチッ」と感触が伝わるクイックシート・コネクションの特長を備えています。術者は、この手応えによって、コンポーネントが正しく装着されたことを確認することができます。



- 補綴物を装着する際、クイックシート・コネクションの把持機能により、アバットメントをインプラントに取り付けることができます。補綴物の完全な固定にはスクリューを使用します。



- 6 / 12角のインターナル・コネクションは、ヘクス（6角）およびダブルヘクス（12角）の組み合わせとなっており、それぞれに特長があります。

ヘクス（6角）：マウントレスでインプラントを埋入する場合、ドライバーチップでインプラントを保持します。また、ストレートタイプのアバットメントの回転を防止します。

ダブルヘクス（12角）：アングル付きアバットメントを装着する際に、30°毎の角度調整ができます。

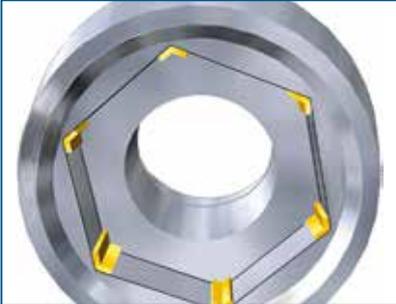


- インプレッション・コーピング：ピックアップ・タイプとトランスファー・タイプの2種類のインプレッション・コーピングが使用できます。インプレッション・コーピングが正しく装着されると「カチッ」と音がします。アバットメントとインプラントが接合される場合、アバットメントの先端は4mm挿入されますが、コーピングの挿入部分は2mmとなります。コーピングの接合部分を短くすることにより、インプラントからの取り外しが容易になります。

(紫)	(青)	(黄)	(緑)
			
3.4mm	4.1mm	5mm	6mm

- サーテン・インプラントとそれに用いるコンポーネントは、プラットフォームの直径に応じてカラー・コード化されています。

インプラント／アバットメント・コネクション（続き）



■ エクスターナル・ヘクス・コネクション

エクスターナルヘクス・インプラント・システムは、幅広く使用されているインプラント・システムです。

- ゴールドスタンダード ZR（ゼロ・ローテーション）は、特許取得済みの設計で、アバットメントのヘクスの角部分に機械加工されたマイクロストップが設けられています。この設計により、インプラントとアバットメント間の水平方向の回転が抑制されます。ゴールドスタンダード ZR は、UCLA アバットメント、ジンジヒュー・ポストに採用されています。



- 12角のダブル・ヘクスによって、角度付きのアバットメントは、30°毎の角度調整が可能です。



- ASYST アバットメント装着ツールを使用することにより、アバットメントを指先で素早く簡単に口腔内へ移動することができます。特許取得済みの包装デザインにより、アバットメントを滅菌状態のままインプラントまで運ぶことができます。アバットメントとアバットメントスクリューは ASYST 装着ツールに取り付けられており、インプラントへ容易に取り付けることができます。ASTYST 装着ツールはロー・プロファイル・アバットメントに付属しています。



- エクスターナル・コネクションには、ピックアップタイプとツイスト・ロック・トランスファーの2種類のコーピングがあり、ヒーリング・アバットメントの種類に応じて、3種類の EP（エマージェンス・プロファイル）径、ストレートタイプから選択できます。特許を取得したツイスト・ロック・デザインの特徴的な溝により、正確な印象採得が可能となり、コーピングを印象内で安定させることができます。コーピングを時計回りに回転させると印象材内に印記されている溝に固定され、インプラント・ヘクスの正確な位置が再現できます。

サーテン・クイックシート・アクチベーター・ツール

サーテン・クイックシート・アクチベーター・ツールは、アバットメントやインプレッション・コーピングのツメを正しく作動させるために使用します（図1）。

サーテン・クイックシート・アクチベーター・ツールには、IMPRESSION COPINGS（インプレッション・コーピング）と ABUTMENTS（アバットメント）のマーキングがされています。

サーテン・クイックシートのツメをクリック ON するために、それぞれに対応する向きで使用します。

- **インプレッション・コーピング**：インプレッション・コーピングのツメをピンに差込み、ツメがツールにあたるまで押し込んでください（図2）。
- **アバットメント**：アバットメントのツメをピンに差込み、プラットフォームがツールにあたるまで押し込んでください（図3）。

ツールから取り外したインプレッション・コーピングまたはアバットメントをインプラントに装着します。

またツール上部には、UCLA アバットメント（ヘクスト）のツメをクリック OFF にする箇所があります（図4）。これは、歯科技工士がワックスアップや仕上げ、または陶材の試適の際にツメが OFF の状態でアバットメントをラポアナログから着脱する方が良い場合に必要になります。カスタムアバットメントまたはクラウンが完成した後は、UCLA アバットメントのツメを再度 ON にします（図5）。



図2

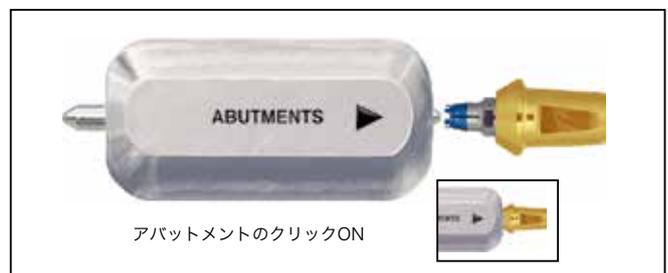


図3



図4

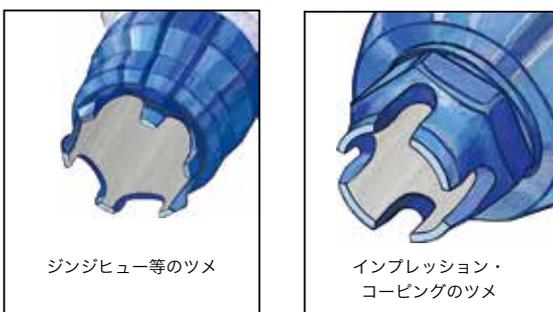


図1



図5

サーテン・ヘクスト／ノンヘクスト・ピックアップ・インプレッション・コーピング許容角度

サーテン・ヘクスト・ピックアップ・インプレッション・コーピングの許容角度

サーテン・ヘクスト・ピックアップ・インプレッション・コーピングは、浅い接続部を備えており、最大 30° までの角度で埋入されたインプラントから着脱することができます。この最大角度はインプレッションコーピング同士が連結固定されていない場合に許容されます (図 1)。

連結した場合のサーテン・ヘクスト・ピックアップ・インプレッション・コーピングおよびノンヘクスト・ピックアップ・インプレッション・コーピングの許容角度

複数本のインプラントで補綴を行う場合、ピックアップ・インプレッション・コーピングを連結して使用することができますが、インプラントが並行に埋入されていない場合には、ヘクスト・ピックアップ・インプレッション・コーピングが着脱できない場合があります。この場合にはインプラントが平行に埋入されている必要があります (図 2)。

ノンヘクスト・ピックアップ・インプレッション・コーピングのインプラント間の最大許容角度は 40° であり、その角度内であれば、連結したインプレッション・コーピングを着脱することができます。ノンヘクスト・ピックアップ・インプレッション・コーピングの接合部分は浅く設計されているため、40° の着脱許容角度を有しています (図 3)。

インプラントが並行に埋入されていない場合にインプレッション・コーピングを連結する際には、ノンヘクスト・ピックアップ・インプレッション・コーピングを使用してください (図 4)。



図1

インプラント間の最大許容角度 30°

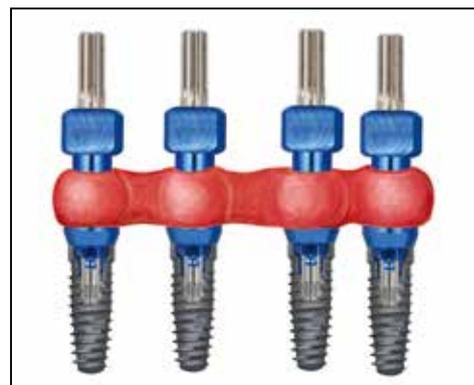


図2

連結されたピックアップ・インプレッション・コーピング(並行に埋入されたインプラント)



図4

ノンヘクスト・ピックアップ・インプレッション・コーピング (並行ではないインプラント)



図3

インプラント間の最大許容角度 40°

サーテン・UCLA アバットメント

サーテン・インターナル・コネクションの補綴コンポーネントには UCLA アバットメントがラインナップされています。UCLA アバットメントのデザインにより、従来の既製アバットメントと比較して、歯科技工士が行うインプラント・レベルでの補綴のワクシングやキャストイングの際の予知性を高め、柔軟に対応できます。

○シリンダー・リテンション・デザイン

金合金シリンダーには機械加工による縦の溝が施されています。この溝によりキャストイング中にシリンダー上へ金属が流れやすくなり、鑄接不良が起こりにくく機械的な保持力も増加します (図 1)。

○シャンファー・マージン

シャンファー・マージンは金合金シリンダーと鑄造金属の接する面がスムーズになっています。またキャストイング中にインプラントとアバットメントの接合部であるプラットフォームへ金属が流れ込むことを防ぎます (図 1)。

○カラーの高さ

0.25mm のカラー高により、軟組織の薄い部位における補綴製作時に柔軟に対応することができます。これにより、インプラントのプラットフォームからすぐに補綴を立ち上げることができ、インプラントのプラットフォームに近い部分から陶材を盛ることができます (図 2)。

○キャストイング後のカラー部の調整

0.25mm 高のカラーにより、インプラントのプラットフォーム周囲がアンダーカットとなる場合があります。キャストイング後、カラー部のアンダーカットを削合して調整します (図 3)。

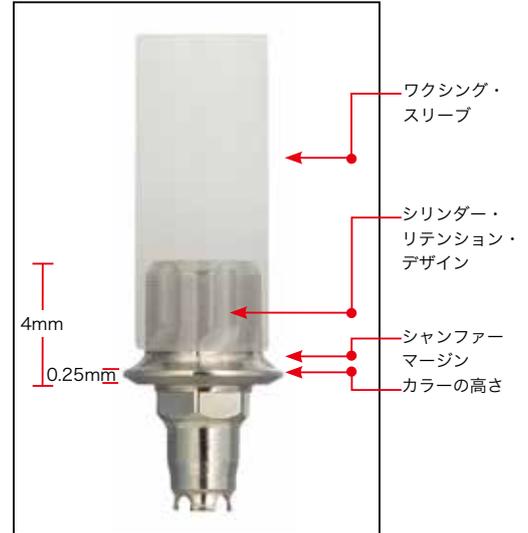


図1

サーテン・UCLA アバットメント

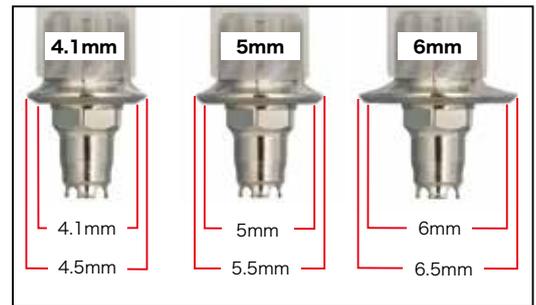


図2

サーテン・UCLA アバットメントのカラー部直径



図3

キャストイング後のサーテン・UCLAアバットメントおよびカラー部調整

サーテン・ノンヘクスト・アバットメント

サーテン・ノンヘクスト・アバットメントは、複数歯の連結、スクリーリテイニングの補綴物の製作、ブリッジフレームやバーの製作時に、歯科技工士が柔軟に対応できるようにデザインされています。

○接合部

ノンヘクスト・アバットメントの接合部は1mmのため、従来のインターナル・コネクション・システムよりも、多様な角度に埋入されたインプラントへの接合を可能にします(図1)。

○ラージ・ダイアメーター・アバットメント・スクリュー

ノンヘクスト・アバットメントは直径の太いゴールドタイト・スクリューもしくはチタン・スクリューを用いてインプラントと接続します。太い直径のスクリューを用いることにより、補綴時の横方向への安定性が増加します。スクリューはインターナル・コネクション内に完全に挿入され、これはヘクスト・アバットメントのコネクション部4mmに相当します(図1)。

○最大許容角度

ノンヘクスト・アバットメントは最大40°までの角度で埋入されたインプラントへ着脱できます(図2)。

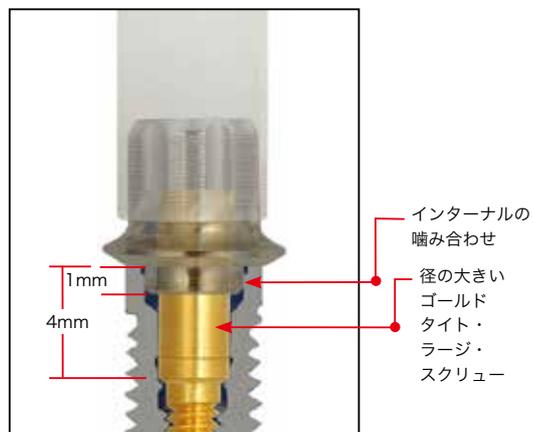


図1

サーテン・UCLAアバットメント
(ノンヘクスト)



図2

インプラント間の最大許容角度は40°

○金合金シリンダー

焼却、 casting時の金合金シリンダーの溶解温度等は右表をご参照ください(図3)。

	華氏 °F	摂氏°C
溶解範囲	2552-2732°F	1400-1500°C
個相点	2552-2579°F	1400-1415°C
液相点	2714-2732°F	1490-1500°C
熱膨張率	12.2 x 10 ⁻⁶ °K at 932°F	12.2 x 10 ⁻⁶ °K at 500°C

図3

金合金の溶解温度

印象採得

コーピングの選択

選択方法

ピックアップ・インプレッション・コーピング (オープン・トレー)

ピックアップ・インプレッション・コーピングを用いてインプラントのヘクスを作業模型に転記します。印象材を口腔内から取り出す際に、コーピングは印象内に取り込まれています。ピックアップ・インプレッション・コーピングを用いる際にはオープン・トレーが使用されます。

注意

- 顎間距離が限られている場合には、使用が難しい場合があります。
- 複数本埋入されたインプラントの印象採得にピックアップ・インプレッション・コーピングを使用することができます (6 ページ参照)。

ツイストロック・トランスファー・コーピング (クローズド・トレー)

ツイストロック・トランスファー・コーピングを用いてインプラントのヘクスを作業模型に転記します。印象材を口腔内から取り出す際に、コーピングは口腔内に残るようにデザインされています。コーピングを口腔内から取り外してアナログを取り付け、アナログ付きのコーピングを印象内に戻します。

注意

- 顎間距離が限られている場合の使用に適しています。
- 複数本埋入され、角度のついたインプラントの印象には使用できません。印象材がセットされた後、印象用トレーが取り出せない可能性があります。

適切なインプレッション・コーピングの選択

インプラントのプラットフォーム上の色を確認し、適切なサイズのピックアップ・タイプもしくはツイストロック・タイプのコーピングを選択します。インプレッション・コーピングの EP 径は、ヒーリング・アバットメントの EP 径に合わせて選択してください。下図参照

ヒーリング・アバットメントの寸法



ピックアップ・インプレッション・コーピングの使用 10 ページ

ツイストロック・トランスファー・コーピングの使用 13 ページ を参照してください

必要なコンポーネント

- プラットフォームおよび EP 径の一致したピックアップ・インプレッション・コーピングまたはツイストロック・トランスファー・コーピング
- それぞれに適合するラボアナログ

必要な器具

- PHD02N または PHD03N ラージ・ヘクス・ドライバー
- ICD00 インプレッション・コーピング・ドライバー (ツイストロック・トランスファーのみ)

印象採得

ピックアップ・インプレッション・コーピング

(イラストはサーテン・
インターナル・コネクション)



歯科医師

1.  ヒーリング・アバットメントのエマージェンス・プロファイル (EP) 径とプラットフォームの直径に合わせて、適切なピックアップ・インプレッション・コーピングを選択します。各径のカラーコードは下図を参照ください。ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N または PHD03N) を用い、インプラントからヒーリング・アバットメントを取り外します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

(紫)	(青)	(黄)	(緑)
			
3.4mm	4.1mm	5mm	6mm

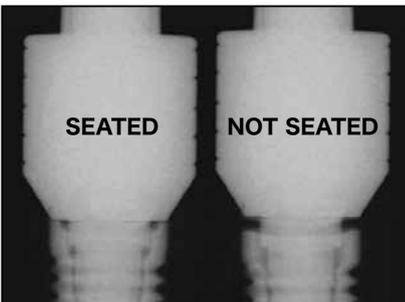


2.  クイックシート・アクチベーター・ツールを用いて、コーピングのツメを ON にします (5 ページ参照)。インプラント内のヘクスに合うようにコーピングを挿入し、クリックの音と感触が得られるまでしっかりと押し込みます。

または、

 インプラントのヘクスに合わせてコーピングを設置します。

 インプレッション・コーピング・スクリューとラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N または PHD03N) を用いてインプラントに装着します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。



3.  X 線像でインプラントとコーピングが確実に接続されているかを確認します。インプラントもしくはアバットメントとコーピングの接合面に垂直となるようにフィルムを設置します。



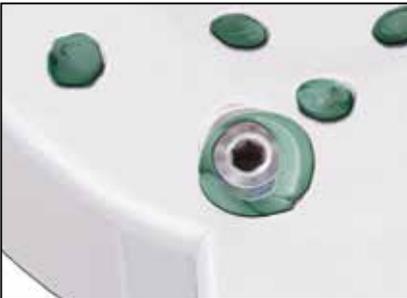
4.  ピックアップ・インプレッション・コーピングには個人用トレーもしくは既製のオープン・トップのトレーを使用します。スクリューヘッドが貫通するようにトレーに小さな穴を開けます。

印象採得

ピックアップ・インプレッション・コーピング (続き)



5.  印象トレーに注入する印象材はミディアムまたはヘビー・ボディの印象材を推奨します。コーピング周囲にはライト・ボディの印象材を注入します。



6.  口腔内にトレーを入れ印象採得します。ヘクス部が視認できるように、印象材が硬化する前にスクリー・ヘッド周囲に付着した印象材を取り除きます。



7.  印象材が硬化した後、ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N または PHD03N) を用いてコーピング・スクリーを取り外します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。印象を口腔内から取り出します。



8.  インプレッション・コーピング周囲の印象が完全に採得できていることを確認します。インプレッション・コーピングの接合面に印象材が付着していないことも確認してください。

印象採得

ピックアップ・インプレッション・コーピング (続き)



9.  ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ (RASH3NまたはRASH8N) とトルク・レンチ (L-TIRW) を用い、ヒーリング・アバットメントを 20Ncm のトルクで直ちにインプラントに再装着します。



歯科技工士

10.  適切な直径のラボ・アナログを選択し、インプレッション・コーピングに取り付けます。ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02NまたはPHD08N) を用いてアナログを装着します。アナログが完全にコーピングと装着されているか、目視で確認します。印象を歯科技工所に送付する際には、アナログを取り外した状態で送付してください。



11.  ガム模型材をインプレッションコーピングとラボアナログの周囲に注入します。硬化後、石膏を流します。

印象採得

ツイストロック・トランスファー・インプレッション・コーピング

(イラストはエクスターナル・コネクション)



歯科医師

1.  ヒーリング・アバットメントのエマーゼンス・プロファイル (EP) 径とプラットフォームの直径に合わせて、適切なツイストロック・トランスファー・インプレッション・コーピングを選択します。各径のカラーコードは下図を参照ください。ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N または PHD03N) を使い、インプラントからヒーリング・アバットメントを取り外します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

(紫)	(青)	(黄)	(緑)
			
3.4mm	4.1mm	5mm	6mm

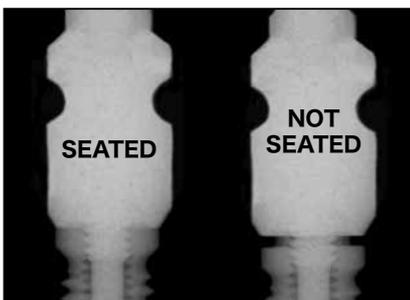


2.  クイックシート・アクチベーター・ツールを用いて、コーピングのツメを ON にします (5 ページ参照)。インプラント内のヘクスに合うようにコーピングを挿入し、クリックの音と感触が得られるまでしっかりと押し込みます。

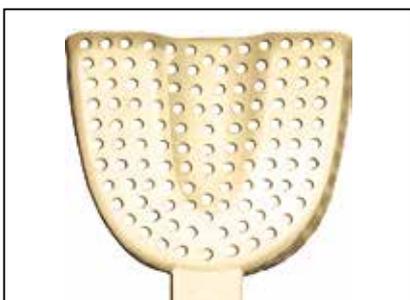
または、

 インプラントのヘクスに合わせてコーピングを設置します。

 インプレッション・コーピング・ドライバー (ICD00) を用いてコーピング・スクリューを手締めで締結し、インプラントに装着します。



3.  X 線像でインプラントにコーピングが確実に接続されているかを確認します。インプラントもしくはアバットメントとコーピングの接合面に垂直となるようにフィルムを設置します。



4.  ツイストロック・トランスファー・インプレッション・コーピングには個人用トレーもしくは既製のトレーを使用します。試適をしてコーピングがトレーに接触しないことを確認します。

印象採得

ツイストロック・トランスファー・インプレッション・コーピング（続き）



5.  印象トレーに注入する印象材はミディアムまたはヘビー・ボディの印象材を推奨します。コーピング周囲にはライト・ボディの印象材を注入します。



6.  口腔内にトレーを入れ印象採得します。印象材の取り扱い方法は製造業者の指示に従ってください。



7.  印象材が硬化した後、印象を口腔内から取り出します。コーピングはインプラントに装着されたままになります。コーピング周囲の印象が確実に採得されていることを確認します。



8.  インプレッション・コーピング・ドライバー（ICD00）を用いて、コーピング・スクリューを緩め、ツイストロック・トランスファー・インプレッション・コーピングをインプラントから取り外します。

印象採得

ツイストロック・トランスファー・インプレッション・コーピング (続き)



9.  ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ (RASH3NまたはRASH8N) とトルク・レンチ (L-TIRW) を用い、ヒーリング・アパットメントを 20Ncm のトルクで直ちにインプラントに再装着します。

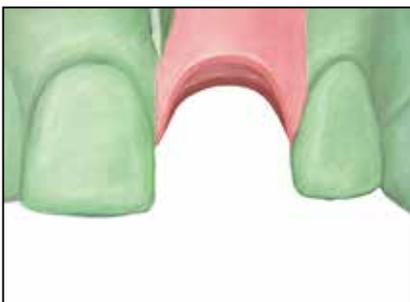


歯科技工士

10.  適切な直径のラボ・アナログを選択し、インプレッション・コーピングに取り付けます。アナログが完全にコーピングと装着されているか、目視で確認します。



11.  アナログが装着されたインプレッション・コーピングを印象内に押し込みます。抵抗が感じられるまでゆっくりと時計回りに回します。コーピングに施された溝と印象が適合することで、インプラントのヘクスを正確に転記します。



12.  ガム模型材をインプレッションコーピングとアナログの周囲に注入します。硬化後、石膏を流します。

アバットメントの選択



歯科医師

1.  ヒーリング・アバットメントのエマージェンス・プロファイル (EP) 径とプラットフォームの直径に合わせてアバットメントのサイズを選択します。インプラントとコンポーネントは、プラットフォームの直径に合わせてカラーコード化されています。(下図参照)

(紫)	(青)	(黄)	(緑)
			
3.4mm	4.1mm	5mm	6mm



2.  アバットメントのカラー部の高さを選択するため、頬側の軟組織から露出しているヒーリング・アバットメントの高さを計測します(ドーム状の隆起部は除く)。ヒーリングアバットメントの高さから計測値を引き、適切なカラー部の高さを選択します。



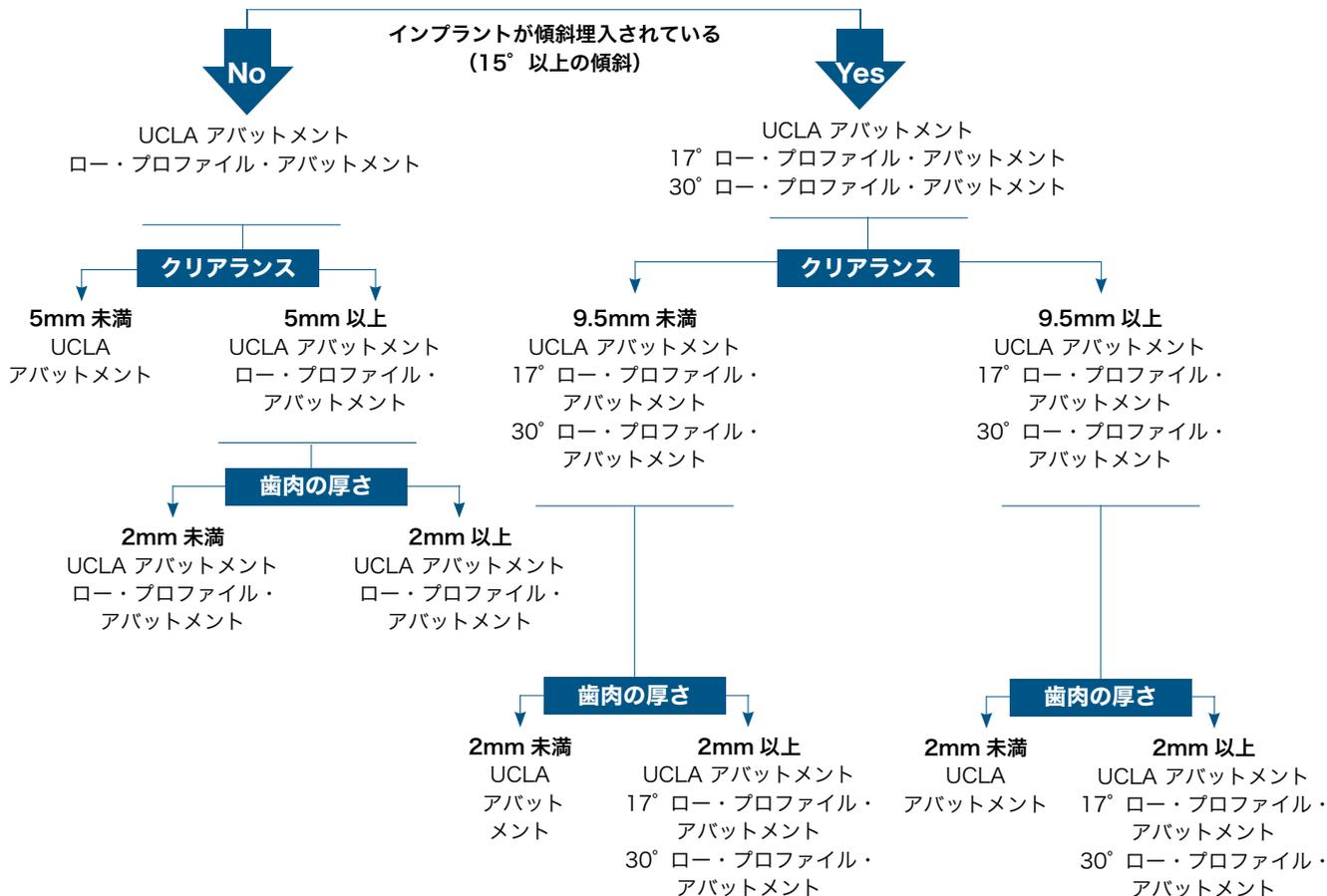
3.  ラージヘクス・ドライバーをヒーリング・アバットメントのヘクスに挿入し、角度を確認します。

アバットメントの選択 (続き)

セメント固定式補綴



スクリュー固定式補綴



セメントリテイニング

プレフォーマンス・ポスト 間接法

材料：

 PEEK、チタン合金

適応：

- 単独歯または多数歯のプロビジョナル・レストレーション（セメント・リテイニング）
- 必要なクリアランス 7mm 以上
- 最大傾斜角度 15°
- 口腔内での使用期限 180 日以内
- 単独歯における即時非咬合荷重のプロビジョナル・レストレーション
- 多数歯の修復において、プロビジョナルへの荷重を最小限にするため、側方、前方、咀嚼力における咬合力を評価する必要があります
- 単独歯または多数歯修復におけるインプラントのインテグレーション後、軟組織の治癒期間中に使用



歯科医師

1.  インプラントレベルの印象を行うため、ピックアップ・タイプは 10-12 ページ、トランスファー・タイプは 13-15 ページを参照してください。

歯科技工士

2.  プレフォーマンス・ポストの選択においては、EP 径、隣接歯間の歯肉の高さや形態を考慮しながらカラー高を決定します。インプラントのプラットフォームと同じカラーコードを選択してください。
 プレフォーマンス・ポストをラボアナログに挿入し、ヘクスを合わせながらクリック音と感触が得られるまで押し込みます。
 ヘクスを合わせながらポストをラボアナログ上に設置します。
 ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、チタン・スクリュー (IUNIHT, UNIHT) をアナログに挿入します。形成の必要な箇所を鉛筆で印をつけます。



3.  カーバイド・バーを用いて形成予定の箇所を加工します。研磨にはダイヤモンド・バーを使用します。補綴学の考え方に沿って、歯肉縁下 1mm もしくは歯肉縁に沿ってマージンを設定します。ポストを模型上に設置、もしくはラボ・ホルダー (ILTAH57, LTAH5, LTAH7) に接続して形成してください。アバットメントの形成では 3 壁は残し、少なくとも 0.5mm の厚さを維持してください。

セメントリテイニング

プレフォーマンス・ポスト 間接法 (続き)



4.  スクリューのアクセスホールを仮充填用の適切な材料で封鎖します。プロビジョナル用の材料を用い、ポスト上でプロビジョナル・クラウンを作製します。

歯科医師

5.  ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、ヒーリング・アパットメントを取り外します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

 クイックシート・アクチベーター・ツールを用いて、プレフォーマンス・ポストのツメを ON にします (5 ページ参照)。ヘクスに合うようにポストを挿入し、クリックの音と感触が得られるまでしっかりと押し込みます。

 形成したポストをインプラントのヘクスに合せて装着します。

 ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、チタン・スクリュー (IUNIHT, UNIHT) をインプラントに手回しで挿入します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

注意：プレフォーマンス・ポストは模型上で形成された時と同じポジションで使用します。ポスト表面に施された印等を参考に、正確に装着してください。



6.  プロビジョナル・クラウンをポスト上で試適し、咬合、マージンとの適合、隣在歯との接触を確認します。

プロビジョナル・クラウンを取り外します。ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ (RASH3N, RASH8N) とトルク・レンチ (L-TIRW) を用いて、スクリューを 20Ncm で締結します。



7.  アクセス・ホールを仮充填用の適切な材料で封鎖します。仮着用セメントでクラウンをポストに装着します。余剰なセメントは取り除いて下さい。

プレフォーマンス・ポストを多数歯における即時非咬合荷重で用いる場合は、次の点に注意してください。

- 天然歯列への連結はしないでください。
- インテグレーションしている他のインプラントに連結する場合には、側方および中心での咬合接触を避けてください。直近に埋入したインプラント上での、咀嚼による接触は避けるか、最小限にしてください。食事制限、コンプライアンスの遵守はこの種の症例における成功には不可欠です。
- 即時埋入されたインプラントに連結する場合、6 週～8 週の間は咬合接触を避け、柔らかい食事を取ることが推奨されます。

セメントリテイニング

プレフォーマンス・ポスト 直接法



歯科医師

1.  プレフォーマンス・ポストの選択においては、EP 径、隣接歯間の歯肉の高さや形態を考慮しながらカラー高を決定します。インプラントのプラットフォームと同じカラーコードを選択してください。

 クイックシート・アクチベーター・ツールを用いて、プレフォーマンス・ポストのツメを ON にします (5 ページ参照)。ヘクスに合うようにポストを挿入し、クリックの音と感触が得られるまでしっかりと押し込みます。

 ポストをインプラントのヘクスに合せて装着します。

 ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、チタン・スクリュー (IUNIHT, UNIHT) をインプラントに手回して挿入します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。形成の必要な箇所鉛筆で印をつけます。



2.  カーバイド・バーを用いて形成予定の箇所を加工します。研磨にはダイヤモンド・バーを使用します。補綴学の考え方に沿って、歯肉縁下 1mm もしくは歯肉縁に沿ってマージンを設定します。ポストを模型上に設置、もしくはラボ・ホルダー (ILTAH57, LTAH5, LTAH7) に接続して形成することも可能です。アバットメントの形成では 3 壁は残し、少なくとも 0.5mm の厚さを維持してください。



3.  アバットメントの形成の後、ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ (RASH3N, RASH8N) とトルク・レンチ (L-TIRW) を用いて、スクリュー (IUNIHT, UNIHT) を 20Ncm で締結します。



4.  アクセス・ホールを仮充填用の適切な材料で封鎖します。仮着用セメントでクラウンをポストに装着します。余剰なセメントは取り除いて下さい。必要に応じて咬合調整を行ってください。セメント固定の前に口腔外で調整を行うことで咬合調整が容易になります。

プレフォーマンス・ポストを多数歯における即時非咬合荷重症例で用いる場合は、次の点に注意してください。

- 天然歯列への連結はしないでください。
- インテグレーションしている他のインプラントに連結する場合には、側方および中心での咬合接触を避けてください。直近に埋入したインプラント上での、咀嚼による接触は避けるか、最小限にしてください。食事制限、コンプライアンスの遵守はこの種の症例における成功には不可欠です。
- 即時埋入されたインプラントに連結する場合、6 週～8 週の間は咬合接触を避け、柔らかい食事を取ることが推奨されます。

セメントリテイニング

15°プレフォーマンス・ポスト 間接法



歯科医師

1.   インプラントレベルの印象を行うため、ピックアップ・タイプは 10-12 ページ、トランスファー・タイプは 13-15 ページを参照してください。



歯科技工士

2.   15°プレフォーマンス・ポストの選択においては、EP 径、隣接歯間の歯肉の高さや形態を考慮しながらカラー高を決定します。インプラントのプラットフォームと同じカラーコードを選択してください。

 ポストをラボアナログに挿入し、12 角のヘクスを合わせながらクリック音と感触が得られるまで押し込みます。

 ヘクスを合わせながらポストをラボアナログ上に設置します。



3.   ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、チタン・スクリュー (IUNIHT, UNIHT) をアナログに挿入します。形成の必要な箇所鉛筆で印をつけます。



4.   カーバイド・バーを用いて形成予定の箇所を加工します。研磨にはダイヤモンド・バーを使用します。補綴学の考え方に沿って、歯肉縁下 1mm もしくは歯肉縁に沿ってマージンを設定します。ポストを模型上に設置、もしくはラボ・ホルダー (ILTAH57, LTAH5, LTAH7) に接続して形成してください。アバットメントの形成では 3 壁は残し、少なくとも 0.5mm の厚さを維持してください。

セメントリテイニング

15°プレフォーマンス・ポスト 間接法（続き）



5.  プロビジョナル用の材料を用い、ポスト上でプロビジョナル・クラウンを作製します。



歯科医師

6.  ラージ・ヘクス・ドライバー（PHD02N, PHD03N）を用いて、ヒーリング・アバットメントを取り外します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

 クイックシート・アクチベーター・ツールを用いて、15°プレフォーマンス・ポストのツメをONにします(5ページ参照)。12角のヘクスに合うようにポストを挿入し、クリックの音と感触が得られるまでしっかりと押し込みます。

 形成したポストをインプラントのヘクスに合せて装着します。

 ラージ・ヘクス・ドライバー（PHD02N, PHD03N）を用いて、チタン・スクリュー（IUNIHT, UNIHT）をインプラントに手回しで挿入します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

注意：プレフォーマンス・ポストは模型上で形成された時と同じポジションで使用します。ポスト表面に施された印等を参考に、正確に装着してください。



7.  プロビジョナル・クラウンをポスト上で試適し、咬合、マージンとの適合、隣在歯との接触を確認します。

プロビジョナル・クラウンを取り外します。ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ（RASH3N, RASH8N）とトルク・レンチ（L-TIRW）を用いて、スクリューを20Ncmで締結します。

8.  アクセス・ホールを仮充填用の適切な材料で封鎖します。仮着用セメントでクラウンをポストに装着します。余剰なセメントは取り除いて下さい。

プレフォーマンス・ポストを多数歯における即時非咬合荷重で用いる場合は、次の点に注意してください。

- ・天然歯列への連結はしないでください。
- ・インテグレーションしている他のインプラントに連結する場合には、側方および中心での咬合接触を避けてください。直近に埋入したインプラント上での、咀嚼による接触は避けるか、最小限にしてください。食事制限、コンプライアンスの遵守はこの種の症例における成功には不可欠です。
- ・即時埋入されたインプラントに連結する場合、6週～8週の間は咬合接触を避け、柔らかい食事をとることが推奨されます。

セメントリテイニング

15°プレフォーマンス・ポスト 直接法



歯科医師

1.  15°プレフォーマンス・ポストの選択においては、EP径、隣接歯間の歯肉の高さや形態を考慮しながらカラー高を決定します。インプラントのプラットフォームと同じカラーコードを選択してください。

 クイックシート・アクチベーター・ツールを用いて、15°プレフォーマンス・ポストのツメをONにします(5ページ参照)。ヘクスに合うようにポストを挿入し、クリックの音と感触が得られるまでしっかりと押し込みます。ポストは、インプラントの傾斜角度を補正するために30°毎の角度調整が可能です。

 ポストをインプラントのヘクスに合せて装着します。

 ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、チタン・スクリュー (IUNIHT, UNIHT) をインプラントに手回しで挿入します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。形成の必要な箇所鉛筆で印をつけます。



2.  カーバイド・バーを用いて形成予定の箇所を加工し、洗い流します。研磨にはダイヤモンド・バーを使用します。補綴学の考え方に沿って、歯肉縁下1mmにマーゼンを設定します。ポストを模型上に設置、もしくはラボ・ホルダー (ILTAH57, LTAH5, LTAH7) に接続して形成することも可能です。アバットメントの形成では3壁は残し、少なくとも0.5mmの厚さを維持してください。



3.  アバットメントの形成の後、ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ (RASH3N, RASH8N) とトルク・レンチ (L-TIRW) を用いて、スクリューを20Ncmで締結します。

4.  アクセス・ホールを仮充填用の適切な材料で封鎖します。仮着用セメントでクラウンをポストに装着します。余剰なセメントは取り除いて下さい。必要な咬合調整を行ってください。

プレフォーマンス・ポストを多数歯における即時非咬合荷重で用いる場合は、次の点に注意してください。

- ・天然歯列への連結はしないでください。
- ・インテグレーションしている他のインプラントに連結する場合には、側方および中心での咬合接触を避けてください。直近に埋入したインプラント上での、咀嚼による接触は避けるか、最小限にしてください。食事制限、コンプライアンスの遵守はこの種の症例における成功には不可欠です。
- ・即時埋入されたインプラントに連結する場合、6週～8週の間は咬合接触を避け、柔らかい食事をとることが推奨されます。



セメントリテイニング

ジンジビュー・ポスト 間接法

材料：

- チタン合金（サーテン®・ストレートおよびすべての15°アングル）
- 純チタン（エクスターナル・ストレート）

適応：

- 単独歯または多数歯における陶材焼付金属修復
- 歯肉変色の可能性のある歯肉が薄い唇側部位での使用
- 多様な歯肉形態に対応
- 通常のクラウン、ブリッジによる修復
- 最大補正角度 15°
- 必要クリアランス 7mm



歯科医師

1. ■ ■ インプラントレベルの印象を行うため、ピックアップ・タイプは10-12ページ、トランスファー・タイプは13-15ページを参照してください。

歯科技工士

2. ■ ■ ジンジビュー・ポストのEP径、ヒーリング・アバットメント、インプラントのプラットフォーム径を基に適切なサイズのポストを選択します。

■ ポストをラボアナログに挿入し、ヘクスを合わせながらクリック音と感触が得られるまで押し込みます。

■ ヘクスを合わせながらポストをラボアナログ上に設置します。

■ ■ ラージ・ヘクス・ドライバー（PHD02N, PHD03N）またはスクエア・ドライバー（PSQD0N, PSQD1N）を用いて、トライイン・スクリュー（MUNITS, IUNITS, UNITS）をインプラントに手回しで挿入します。形成の必要な箇所に鉛筆で印をつけます。



ストレート

角度付き

3. ■ ■ カーバイド・バーを用いて形成予定の箇所を加工します。補綴学の考え方に沿って、歯肉縁下1mmもしくは歯肉縁に沿ってマージンを設定します。ポストを模型上に設置、もしくはラボ・ホルダー（ILTAH57, LTAH5, LTAH7）に接続して形成してください。



4. ■ ■ 形成したアバットメント上で、最終補綴物のワックスアップを行います。ワックスパターンを埋没、焼却、鑄造し陶材を築盛します。

セメントリテイニング

ジンジビュー・ポスト 間接法 (続き)



歯科医師

5.  ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、ヒーリング・アパットメントを取り外します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

 クイックシート・アクチベーター・ツールを用いて、ジンジビュー・ポストのツメをONにします (5 ページ参照)。ヘクスに合うようにポストを挿入し、クリックの音と感触が得られるまでしっかりと押し込みます。ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、ゴールドタイト・スクリュー (IUNIHG) をインプラントに手回しで挿入します。

 形成したポストをインプラントのヘクスに合せて装着します。スクエア・ドライバー (PSQD0N, PSQD1N) を用いて、ゴールドタイト・スクリュー (UNISG) をインプラントに手回しで挿入します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

 X線像でアパットメントが確実に接続されていることを確認してください。



6.  補綴物をジンジビュー・ポストに試適し、咬合、マージンとの適合、隣在歯との接触を確認します。

 ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ (RASH3N, RASH8N) とトルク・レンチ (L-TIRW) を用いて、ゴールドタイト・スクリュー (IUNIHG) を 20Ncm で締結します。

 スクエア・ドライバー・チップ (RASQ3N, RASQ8N) とトルク・レンチ (L-TIRW) を用いて、ゴールドタイト・スクエア・スクリュー (UNISG) を 32-35Ncm で締結します。

 アクセス・ホールを仮充填用の適切な材料で封鎖します。仮着用または合着用セメントで補綴物をポストに装着します。

セメントリテイニング

ジンジビュー・ポスト 直接法



歯科医師

1.   ジンジビュー・ポストのEP径、ヒーリング・アバットメント、インプラントのプラットフォーム径を基に適切なサイズのポストを選択します。ラージ・ヘクス・ドライバー（PHD02N, PHD03N）を用いて、ヒーリング・アバットメントを取り外します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

 クイックシート・アクチベーター・ツールを用いて、ジンジビュー・ポストのツメをONにします（5ページ参照）。ヘクスに合うようにポストを挿入し、クリックの音と感触が得られるまでしっかりと押し込みます。

 ヘクスを合わせながらポストをインプラント上に設置します。

  トライイン・スクリュー（MUNITS、IUNITS、UNITS）をラージ・ヘクス・ドライバー（PHD02N、PHD03N）を用いてインプラントに手締めで挿入します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。X線像でアバットメントがインプラントに確実に装着されていることを確認します。形成の必要な箇所に鉛筆で印をつけます。



2.   印をつけた箇所を、ハイスピード・ハンドピースに取り付けたカーバイド・バーを用いて、注水しながら形成します。補綴学の考え方に沿って、歯肉縁下1mmもしくは歯肉縁に沿ってマージンを設定します。ポストの形成は口腔内で行うか、ラボ・ホルダー（ILTAH57, LTAH5, LTAH7）に接続して形成してください。



3.   形成が完了した後、トライイン・スクリューを次のスクリューと交換します。
 サーテン・インターナルの場合には、ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ（RASH3N, RASH8N）とトルク・レンチ（L-TIRW）を用いて、ゴールドタイト・スクリュー（IUNIHG）を20Ncmで締結します。

 エクスターナル・ヘクスの場合には、スクエア・ドライバー・チップ（RASQ3N, RASQ8N）とトルク・レンチ（L-TIRW）を用いて、ゴールドタイト・スクエア・スクリュー（UNISG）を32-35Ncmで締結します。

セメントリテイニング

ジンジビュー・ポスト 直接法（続き）



4.  スクリュー・ヘッドを保護するために保護材をアクセス・ホールに挿入し、仮充填用の適切な材料で封鎖します。ジンジビュー・ポスト上に形成されたマージンから歯肉を圧排するために、圧排糸を歯肉縁下に挿入します。ライト・ボディの印象材をポストの周囲に注入します。ミディアムまたはヘビー・ボディの印象材を盛ったトレーを口腔内に装着します。印象材の製造者の指示に従い、印象材を取り扱ってください。

注意：通常、アバットメントの周囲に圧排糸を挿入することは、天然歯における圧排糸の挿入よりも難しくなります。



5.  印象を口腔内から取り出し、マージン部が確実に印象採得されていることを確認します。



6.  通法に従い、ジンジビュー・ポスト上に暫間補綴物を作成します。セメントで固定する前に、ワックスでスクリュー・アクセス・ホールをブロック・アウトしてください。



歯科技工士

7.  石膏を流し、作業用模型を作製します。

セメントリテイニング

ジンジビュー・ポスト 直接法（続き）



8.  模型上で最終補綴物のワックスアップを行います。ワックスパターンを埋没、焼却、鑄造し、陶材を築盛します。



歯科医師

9.  ジンジビュー・ポストから暫間補綴物を取り外し、残ったセメントをきれいに除去します。補綴物をポストに試適し、咬合、マージンとの適合、隣在歯との接触を確認します。仮着用あるいは合着用セメントで補綴物を装着します。余剰なセメントは丁寧に取り除きます。

セメントリテイニング

UCLAアバットメント 単独歯 間接法

材料：

 金合金
プラスチック・スリーブ

適応：

- セメント固定による単独歯または多数歯修復に使用
- 歯科技工所の製作によるカスタム・アバットメントに使用
- 必要なクリアランス 6mm 以上
- 歯肉の厚みに制限がある場合の審美的修復に使用
- 最大角度補正 30°



歯科医師

-  インプラントレベルの印象を行うため、ピックアップ・タイプは 10-12 ページ、トランスファー・タイプは 13-15 ページを参照してください。

歯科技工士

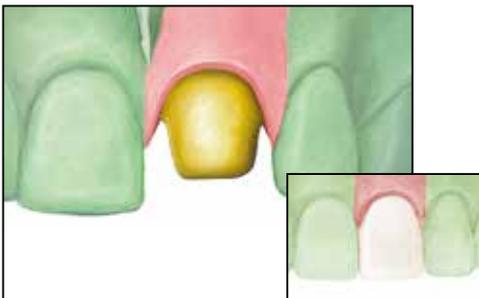
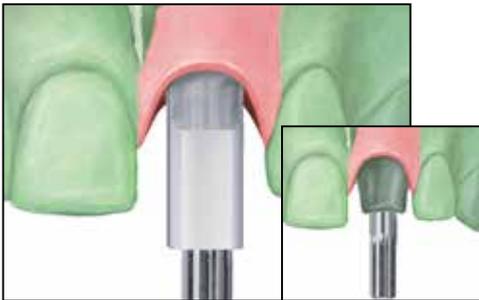
-  クイックシート・アクチベーター・ツールを用いて、UCLA アバットメントのツメを OFF にします (5 ページ参照)。適切なサイズのアバットメントを選択し、インプラント・アナログに装着します。

 適切なサイズの UCLA アバットメントを、ヘクスが合うようにアナログに装着します。

 トライイン・スクリュー (MUNITS, IUNITS, UNITS) またはワクシング・スクリュー (IWSU30, WSU30) を挿入し、ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて手締めで固定します。必要に応じてプラスチックスリーブを削合、調整してください。カスタム・アバットメントとして理想的なエマージェンス・プロファイル、角度、マージンとなるようにワックスアップを行います。

-  ワックス・アップしたカスタム・アバットメントをアナログから注意深く取り外し、埋没、焼却、鑄造します (8 ページ参照)。溶剤で埋没材を分離し、カスタム・アバットメントを仕上げます。ポリッシング・プロテクターを取り付け、アバットメントおよび歯肉縁下に位置する部分を研磨します。

-  作製したカスタム・アバットメントを模型のアナログに接続してトライイン・スクリューを挿入し、ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて手締めで固定します。アクセス・ホールをワックスで封鎖します。通法に従い、カスタム・アバットメント上で、PFM クラウンのワックスアップを行い、埋没、焼却、鑄造し、陶材を築盛します。



セメントリテイニング

UCLAアバットメント 単独歯 間接法 (続き)



歯科医師

5.  ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、ヒーリング・アバットメントを取り外します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

 クイックシート・アクチベーター・ツールを用いて、UCLA アバットメントのツメを ON にします (5 ページ参照)。ヘクスに合うようにアバットメントを挿入し、クリックの音と感触が得られるまでしっかりと押し込みます。ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、ゴールドタイト・スクリュー (IUNIHG) をインプラントに手回して挿入します。

 ヘクスを合わせながらアバットメントをインプラント上に設置します。

スクエア・ドライバー (PSQD0N, PSQD1N) を用いてゴールドタイト・スクエア・スクリュー (UNISG) を挿入します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

 X線像でアバットメントが確実に接続されていることを確認してください。

注意：アバットメントは模型上と同じ位置で装着する必要があります。アバットメント表面に施された印等を参考に、正確に装着してください。

6.  補綴物をカスタム・アバットメントに試適します。咬合、隣在歯との接触、マージンとの適合を確認し、一旦補綴物を取り外します。

 サーテン・インターナルの場合には、ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ (RASH3N, RASH8N) とトルク・レンチ (L-TIRW) を用いて、ゴールドタイト・スクリュー (IUNIHG) を 20Ncm で締結します。

 エクスターナル・ヘクスの場合には、スクエア・ドライバー・チップ (RASQ3N, RASQ8N) とトルク・レンチ (L-TIRW) を用いて、ゴールドタイト・スクエア・スクリュー (UNISG) を 32-35Ncm で締結します。

 アクセス・ホールを仮充填用の適切な材料で封鎖します。仮着用または合着用セメントで補綴物をアバットメントに装着します。余剰なセメントは取り除いて下さい。

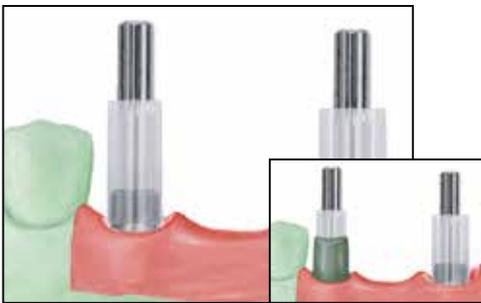
セメントリテイニング

UCLAアバットメント 多数歯 間接法



歯科医師

1.   インプラントレベルの印象を行うため、ピックアップ・タイプは 10-12 ページ、トランスファー・タイプは 13-15 ページを参照してください。



歯科技工士

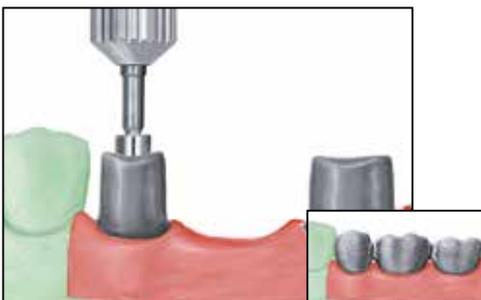
2.  クイックシート・アクチベーター・ツールを用いて、ヘクスト UCLA アバットメントのツメを OFF にします (5 ページ参照)。適切なサイズのアバットメントを選択し、インプラント・アナログに装着します。

 適切なサイズのヘクスト UCLA アバットメントを、ヘクスが合うようにアナログに装着します。

  トライイン・スクリュー (MUNITS, IUNITS, UNITS) またはワクシング・スクリュー (IWSU30, WSU30) を挿入し、ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて手締めで固定します。必要に応じてプラスチックスリーブを削合、調整してください。カスタム・アバットメントとして理想的なエマージェンス・プロファイル、角度、マージンとなるようにワックスアップを行います。



3.   ワックス・アップしたカスタム・アバットメントをアナログから注意深く取り外し、埋没、焼却、鑄造します (8 ページ参照)。溶剤で埋没材を分離し、カスタム・アバットメントを仕上げます。ポリッシング・プロテクターを取り付け、アバットメントおよび歯肉縁下に位置する部分を研磨します。



4.   作製したカスタム・アバットメントを模型のアナログに接続してトライイン・スクリューを挿入します。ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて手締めで固定します。アクセス・ホールをワックスで封鎖します。カスタム・アバットメント上で、メタル・フレームのワックスアップを行い、ワックス・パターンを埋没、焼却、鑄造します。試適のためにメタル・フレームを歯科医に送ります。

セメントリテイニング

UCLAアバットメント 多数歯 間接法 (続き)



歯科医師 (メタルフレームの試適)

5.  ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、ヒーリング・アバットメントを取り外します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

 クイックシート・アクチベーター・ツールを用いて、UCLA アバットメントのツメを ON にします (5 ページ参照)。ヘクスに合うようにアバットメントを挿入し、クリックの音と感触が得られるまでしっかりと押し込みます。

 ヘクスを合わせながらアバットメントをインプラント上に設置します。

 各アバットメントにトライイン・スクリューを挿入し、ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて手締めで固定します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

6.  アバットメントが確実に接続されていることを X 線像で確認します。メタル・フレームをカスタムアバットメントに装着し、アバットメントのマージンにメタル・フレームが完全に適合していることを確認してください。歯肉縁下のマージンを確認するために、必要に応じて X 線撮影を行ってください。不適合となる場合には、メタル・フレームをカットし、口腔内でインデックスを作製します。直ちに、ヒーリング・アバットメントをインプラントに接続します。

注意：アバットメントは模型上と同じ位置で装着する必要があります。アバットメント表面に施された印等を参考に、正確に装着してください。

 接合のためにメタル・フレームを歯科技工士に送付します。完全な適合のために、追加のメタル・フレームが必要になる場合があります。



歯科技工士

7.  トライイン・スクリューを用い、カスタム・アバットメントを模型上のアナログに接続します。メタル・フレームに陶材を築盛します。

セメントリテイニング

UCLAアバットメント 多数歯 間接法 (続き)



歯科医師

8.  ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、ヒーリング・アバットメントを取り外します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

 クイックシート・アクチベーター・ツールを用いて、ヘクスト UCLA アバットメントのツメを ON にします (5 ページ参照)。ヘクスに合うようにアバットメントを挿入し、クリックの音と感触が得られるまでしっかりと押し込みます。ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、ゴールドタイト・スクリュー (IUNIHG) をインプラントに手回して挿入します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

 ヘクスを合わせながらアバットメントをインプラント上に設置します。スクエア・ドライバー (PSQD0N, PSQD1N) を用いてゴールドタイト・スクエア・スクリュー (UNISG) を挿入します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

 X 線像でアバットメントが確実に接続されていることを確認してください。

注意：アバットメントは模型上と同じ位置で装着する必要があります。アバットメント表面に施された印等を参考に、正確に装着してください。



9.  カスタム・アバットメントに補綴物を試適します。咬合、マージンとの適合、隣在歯との接触を確認します。

 サーテン・インターナルの場合には、ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ (RASH3N, RASH8N) とトルク・レンチ (L-TIRW) を用いて、ゴールドタイト・スクリュー (IUNIHG) を 20Ncm で締結します。

 エクスターナル・ヘクスの場合には、スクエア・ドライバー・チップ (RASQ3N, RASQ8N) とトルク・レンチ (L-TIRW) を用いて、ゴールドタイト・スクエア・スクリュー (UNISG) を 32-35Ncm で締結します。

10.  スクリューの頭部に保護材を置き、アクセス・ホールを仮充填用の適切な材料で封鎖します。仮着用または合着用セメントで補綴物をアバットメントに装着します。余剰なセメントは取り除いて下さい。

注意：補綴物の研磨は、セメント固定の前に口腔外で行ってください。

スクリューリテイニング

プレフォーマンス・テンポラリー・シリンダー 単独歯 間接法

材料：

 PEEK、チタン合金

適応：

- ・単独歯または多数歯のプロビジョナル・レストレーション（スクリュー・リテイニング）
- ・必要なクリアランス 6mm 以上
- ・最大傾斜角度 15°
- ・口腔内での使用期限 180 日以内
- ・単独歯における即時非咬合荷重のプロビジョナル・レストレーション
- ・多数歯の修復においては、プロビジョナル・アバットメントへの荷重を最小限にしてください
- ・単独歯または多数歯修復におけるインプラントのインテグレーション後、軟組織の治癒期間中に使用

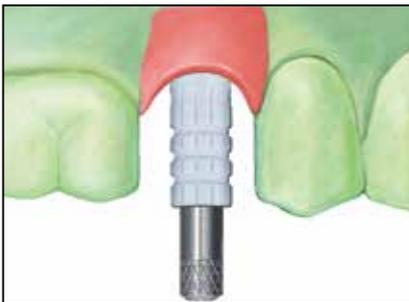
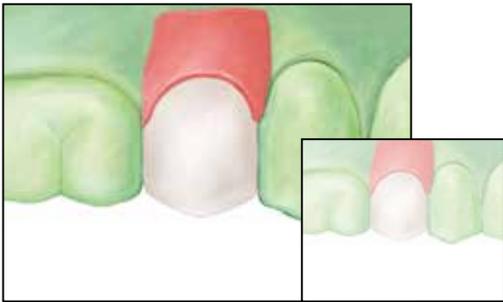


歯科医師

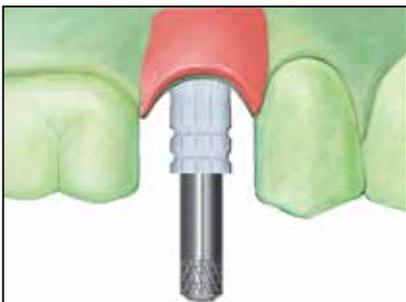
1.  インプラントレベルの印象を行うため、ピックアップ・タイプは 10-12 ページ、トランスファー・タイプは 13-15 ページを参照してください。

歯科技工士

2.  模型上の欠損歯の箇所にはワックスで人工歯を取り付けます。模型上の人工歯と隣在歯の上からバキューム・フォーム・テンプレートを製作します。テンプレート、人工歯、ワックスを模型から取り外します。



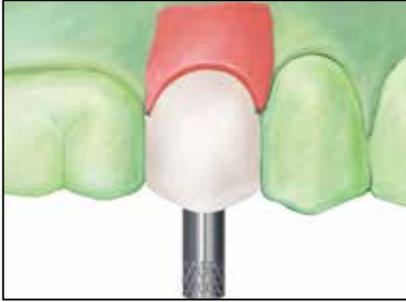
3.  カラーコードを参考に、適切な直径のプレフォーマンス・テンポラリー・シリンダーを選択します。インプラント・アナログ内のヘクスに合うようにシリンダーを挿入し、クリックの音と感触が得られるまでしっかりと押し込みます（5 ページ参照）。
 適切なサイズのプレフォーマンス・テンポラリー・シリンダーをアナログのヘクスに合せて設置します。
 ワクシング・スクリュー（IWSU30, WSU30）を、ラージ・ヘクス・ドライバー（PHD02N または PHD03N）を用いてアナログに装着します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。



4.  必要に応じて、テンポラリー・シリンダーを削合し、調整します。隣在歯とのコンタクト部から根尖方向のアンダーカット部をブロックアウトします。

スクリーリテイニング

プレフォーマンス・テンポラリー・シリンダー 単独歯 間接法 (続き)



5.  ワクシング・スクリー (WSU30, WSU30) が通るよう、テンプレートにホールを形成します。アクリル・レジンにシリンダーおよびテンプレートに流し、プロビジョナル・クラウンを作製するためにテンプレートを模型上に設置します。アクリル・レジンの操作方法は製造業者の指示に従ってください。模型からワクシング・スクリーとテンプレートを取り外します。テンプレートからクラウンを取り外します。補綴物のプラットフォームに合う、適切なラボ・アナログを装着します。歯肉縁下周囲に欠損部があれば修正します。クラウンを再度模型に戻します。チタン・スクリー (IUNIHT, UNIHT) を挿入し、ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、手回しでアナログに固定します。



歯科医師

6.  ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、ヒーリング・アバットメントを取り外します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。
-  クイックシート・アクチベーター・ツールを用いて、プレフォーマンス・テンポラリー・シリンダーのツメを ON にします(ページ5 参照)。ヘクスに合うようにクラウンを挿入し、クリックの音と感触が得られるまでしっかりと押し込みます。
-  製作したプロビジョナル・クラウンをインプラントのヘクスに合せて装着します。
-  チタン・スクリー (IUNIHT, UNIHT) を挿入し、ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、手回しでインプラントに固定します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。隣在歯との接触を確認します。ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ (RASH3N, RASH8N) とトルク・レンチ (L-TIRW) を用いて、スクリーを 20Ncm で締結します。スクリーの頭部に保護材を置き、アクセス・ホールを仮充填用の適切な材料とコンポジットレジンで封鎖します。必要に応じて咬合の調整を行ってください。

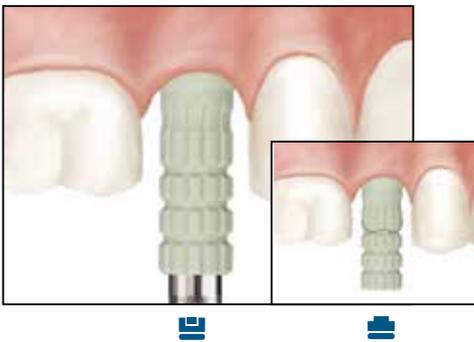
スクリーリテイニング

プレフォーマンス・テンポラリー・シリンダー 単独歯 直接法



歯科技工士

1.  模型上の欠損歯の箇所にはワックスで人工歯を取り付けます。模型上の人工歯と隣在歯の上からバキューム・フォーム・テンプレートを製作します。テンプレート、人工歯、ワックスを模型から取り外します。



歯科医師

2.  カラーコードを参考に、適切な直径のプレフォーマンス・テンポラリー・シリンダーを選択します。インプラント内のヘクスに合うようにシリンダーを挿入し、クリックの音と感触が得られるまでしっかりと押し込みます。(5 ページ参照)

 適切なサイズのプレフォーマンス・テンポラリー・シリンダーをインプラントのヘクスに合わせて設置します。

 ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N または PHD03N) を用いて、ワクシング・スクリー (IWSU30, WSU30) をインプラントに挿入します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。形成の必要な箇所に鉛筆で印をつけます。



3.  シリンダーの形成は口腔内で行うか、ラボ・ホルダー (ILTAH57, LTAH5, LTAH7) に接続して形成してください。ハイスピード・ハンドピースに取り付けた粗いダイヤモンド・バーを用いて、注水しながら形成します。



4.  ワクシング・スクリーが通るよう、テンプレートにホールを形成します。アクリル・レジンをシリンダーおよびテンプレートに流し、テンプレートをシリンダー上に設置します。アクリル・レジンの操作方法は製造業者の指示に従ってください。口腔内からワクシング・スクリーとテンプレートを取り外します。テンプレートからクラウンを取り外します。歯肉縁下周囲に欠損部があれば修正します。クラウンを研磨、調整し、再度インプラントに設置します。チタン・スクリー (IUNIHT, UNIHT) を挿入し、ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ (RASH3N, RASH8N) とトルク・レンチ (L-TIRW) を用いて、スクリーを 20Ncm で締結します。スクリーの頭部に保護材を置き、アクセス・ホールを仮充填用の適切な材料とコンポジットレジンで封鎖します。必要に応じて咬合の調整を行ってください。

スクリーリテイニング

プレフォーマンス・テンポラリー・シリンダー 多数歯 間接法



歯科医師

1.   インプラントレベルの印象を行うため、ピックアップ・タイプは 10-12 ページ、トランスファー・タイプは 13-15 ページを参照してください。

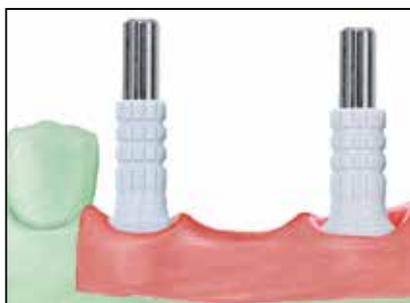


歯科技工士

2.   模型上の欠損歯の箇所にワックスで人工歯を取り付けます。



3.   模型上の人工歯と隣在歯の上からバキューム・フォーム・テンプレートを製作します。テンプレート、人工歯、ワックスを模型から取り外します。



4.   カラーコードを参考に、適切な直径のノン・ヘクスト・プレフォーマンス・テンポラリー・シリンダーを選択します。ラージ・ヘクス・ドライバー（PHD02N または PHD03N）を用いて、ワクシング・スクリュー（WSU30, WWSU30）をアナログに挿入します。

スクリーリテイニング

プレフォーマンス・テンポラリー・シリンダー 多数歯 間接法 (続き)



5.  必要に応じてシリンダーを削合し、調整します。シリンダーを矯正用ワイヤーで連結することや、フレームを作製してポンティックを支えることができます。隣在歯とのコンタクト部から根尖方向へのアンダーカット部をブロックアウトします。



6.  ワクシング・スクリーが通るよう、テンプレートにホールを形成します。暫間補綴物を作製するために、アクリル・レジンをシリンダーおよびテンプレートに流します。テンプレートを模型上に設置します。アクリル・レジンの操作方法は製造業者の指示に従ってください。模型からワクシング・スクリーとテンプレートを取り外します。テンプレートから補綴物を取り外します。適切なアナログを補綴物に接続します。歯肉縁下周囲に欠損部があれば修正します。補綴物を研磨、調整し、再度模型に設置します。チタン・スクリー (IUNIHT, UNIHT) を挿入し、ラーズ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、手回しでアナログに固定します。



歯科医師

7.  ラーズ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、ヒーリング・アパットメントを取り外します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。インプラント上に暫間補綴物を設置します。チタン・スクリー (IUNIHT, UNIHT) を挿入し、ラーズ・ヘクス・ドライバーを用いて、手回しでインプラントに固定します。

隣在歯との接触、咬合の確認、調整を行います。ラーズ・ヘクス・ドライバー・チップ (RASH3N, RASH8N) とトルク・レンチ (L-TIRW) を用いて、スクリーを 20Ncm で締結します。スクリーの頭部に保護材を置き、アクセス・ホールを仮充填の適切な材料とコンポジットレジンで封鎖します。必要に応じて咬合の調整を行ってください。

スクリーリテイニング

インプラント・テンポラリー・シリンダー 単独歯 間接法

材料：

 チタン合金

適応：

- 単独歯または多数歯のプロビジョナル・レストレーション（スクリーリテイニング）
- 必要なクリアランス 6mm 以上
- 最大補正角度 15°
- 単独歯における即時非咬合荷重のプロビジョナル・レストレーション
- 多数歯の修復において、プロビジョナルへの荷重を最小にするため、咬合力を評価する必要があります
- 単独歯または多数歯修復におけるインプラントのインテグレーション後、軟組織の治癒期間中に使用



歯科医師

1.   インプラントレベルの印象を行うため、ピックアップ・タイプは 10-12 ページ、トランスファー・タイプは 13-15 ページを参照してください。



歯科技工士

2.   模型上の欠損歯の箇所にワックスで人工歯を取り付けます。



3.   模型上の人工歯と隣在歯の上からバキューム・フォーム・テンプレートを製作します。テンプレート、人工歯、ワックスを模型から取り外します。



4.  カラーコードを参考に、適切な直径のヘクス・インプラント・テンポラリー・シリンダーを選択します。インプラント・アナログ内のヘクスに合うようにシリンダーを挿入し、クリックの音と感触が得られるまでしっかりと押し込みます（5 ページ参照）。

 適切なサイズのヘクス・インプラント・テンポラリー・シリンダーをアナログのヘクスに合わせて設置します。

 ワクシング・スクリー（IWSU30, WSU30）を、ラーズ・ヘクス・ドライバー（PHD02N または PHD03N）を用いてアナログに挿入します。誤飲を避けるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

スクリーリテイニング

インプラント・テンポラリー・シリンダー 単独歯 間接法 (続き)



5.  必要に応じてシリンダーを削合し、調整します。隣在歯とのコンタクト部から根尖方向へのアンダーカット部をブロックアウトします。



6.  ワクシング・スクリーが通るよう、テンプレートにホールを形成します。アクリル・レジンをシリンダーおよびテンプレートに流し、プロビジョナル・クラウンを作製するためにテンプレートを模型上に設置します。アクリル・レジンの操作方法は製造業者の指示に従ってください。模型からワクシング・スクリーとテンプレートを取り外します。テンプレートからクラウンを取り外します。補綴物のプラットフォームに合う適切なラボ・アナログを装着します。歯肉縁下周囲に欠損部があれば修正します。研磨、調整をして、再度クラウンを模型に戻します。チタン・スクリー (IUNIHT, UNIHT) を挿入し、ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、手回しでアナログに固定します。必要に応じて咬合の調整を行ってください。



歯科医師

7.  ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、ヒーリング・アパットメントを取り外します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

 クリックシート・アクチベーター・ツールを用いて、インプラント・テンポラリー・シリンダーのツメを ON にします (5 ページ参照)。ヘクスに合うようにクラウンを挿入し、クリックの音と感触が得られるまでしっかりと押し込みます。

 製作したプロビジョナル・クラウンをインプラントのヘクスに合わせて装着します。

 チタン・スクリー (IUNIHT, UNIHT) を挿入し、ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、手回しでインプラントに固定します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。X 線像で確実に接続されていることを確認してください。隣在歯との接触、咬合の確認、調整を行います。ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ (RASH3N, RASH8N) とトルク・レンチ (L-TIRW) を用いて、スクリーを 20Ncm で締結します。スクリーの頭部に保護材を置き、アクセス・ホールを仮充填用の適切な材料とコンポジットレジンで封鎖します。必要に応じて咬合の調整を行ってください。

スクリーリテイニング

インプラント・テンポラリー・シリンダー 多数歯 間接法



歯科医師

1.   インプラントレベルの印象を行うため、ピックアップ・タイプは 10-12 ページ、トランスファー・タイプは 13-15 ページを参照してください。

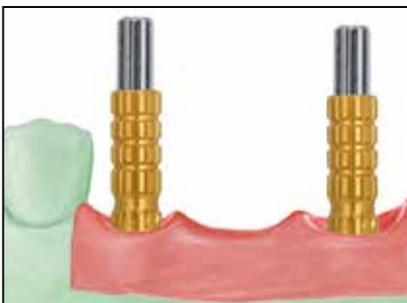


歯科技工士

2.   模型上の欠損歯の箇所にワックスで人工歯を取り付けます。



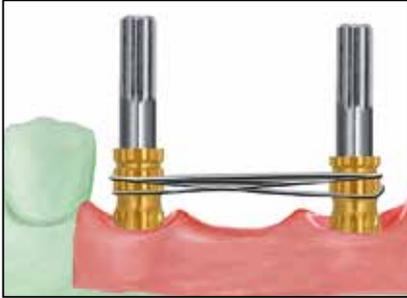
3.   模型上の人工歯と隣在歯の上からバキューム・フォーム・テンプレートを作成します。テンプレート、人工歯、ワックスを模型から取り外します。



4.   適切な直径のノン・ヘクスト・インプラント・テンポラリー・シリンダーを選択します。ラージ・ヘクス・ドライバー（PHD02N または PHD03N）を用いて、ワクシング・スクリュー（IWSU30, WSU30）を手回しでアナログに挿入します。

スクリーリテイニング

インプラント・テンポラリー・シリンダー 多数歯 間接法 (続き)



5.  必要に応じてシリンダーを削合し、調整します。シリンダーを矯正用ワイヤーで連結することや、フレームを作製してポンティックを支えることができます。隣在歯とのコンタクト部から根尖方向へのアンダーカット部をブロックアウトします。



6.  ワクシング・スクリーが通るよう、テンプレートにホールを形成します。暫間補綴物を作製するために、アクリル・レジンをシリンダーおよびテンプレートに流します。テンプレートを模型上に設置します。アクリル・レジンの操作方法は製造業者の指示に従ってください。模型からワクシング・スクリーとテンプレートを取り外します。テンプレートから補綴物を取り外します。適切なアナログを補綴物に接続します。歯肉縁下周囲に欠損部があれば修正します。補綴物を研磨、調整し、再度模型に設置します。チタン・スクリー (IUNIHT, UNIHT) を挿入し、ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、手回しでアナログに固定します。必要に応じて咬合の調整を行ってください。



歯科医師

7.  ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、ヒーリング・アパットメントを取り外します。インプラント上に暫間補綴物を設置します。チタン・スクリー (IUNIHT, UNIHT) を挿入し、ラージ・ヘクス・ドライバーを用いて、手回しでインプラントに固定します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

X線像で確実に接続されているかを確認してください。隣在歯との接触、咬合の確認、調整を行います。ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ (RASH3N, RASH8N) とトルク・レンチ (L-TIRW) を用いて、スクリーを 20Ncm で締結します。スクリーの頭部に保護材を置き、アクセス・ホールを仮充填用の適切な材料とコンポジットレジンで封鎖します。必要に応じて咬合の調整を行ってください。

スクリーリテイニング

UCLAアバットメント 単独歯 間接法

材料:

 金合金
プラスチック・スリーブ

適応:

- スクリー固定による単独歯または多数歯修復に使用
- 必要なクリアランス 4mm 以上
- 歯肉の厚みに制限がある場合の審美的修復に使用

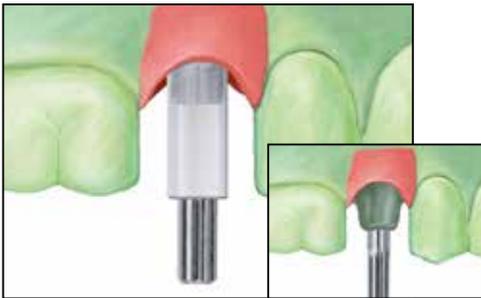


歯科医師

1.  インプラントレベルの印象を行うため、ピックアップ・タイプは 10-12 ページ、トランスファー・タイプは 13-15 ページを参照してください。

歯科技工士

2.  クイックシート・アクチベーター・ツールを用いて、ヘクスト UCLA アバットメントのツメを OFF にします (5 ページ参照)。適切なサイズのアバットメントを選択し、インプラント・アナログに装着します。
 適切なサイズのヘクスト UCLA アバットメントを、ヘクスが合うようにアナログに装着します。
 トライイン・スクリー (MUNITS, IUNITS, UNITS) またはワクシング・スクリー (IWSU30, WSU30) を挿入し、ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて手締めで固定します。必要に応じてプラスチックスリーブを削合、調整してください。カスタム・メタル・フレームの輪郭をワックスアップします。



3.  トライイン・スクリーまたはワクシング・スクリーを取り外し、ワックスアップしたフレームをアナログから注意深く取り外し、埋没、焼却、鋳造します (8 ページ参照)。溶剤で埋没材を分離し、メタル・フレームを仕上げます。



スクリーリテイニング

UCLAアバットメント 単独歯 間接法 (続き)



4.  模型上にメタル・フレームを戻し、トライイン・スクリューまたはワクシング・スクリューを用いてアナログに手締めで接続します。フレームに陶材を築盛します。UCLA アバットメントにポリッシング・プロテクターを取り付け、研磨します。



歯科医師

5.  ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、ヒーリング・アバットメントを取り外します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

 クイックシート・アクチベーター・ツールを用いて、UCLA アバットメントのツメを ON にします (5 ページ参照)。ヘクスに合うようにクラウンを挿入し、クリックの音と感触が得られるまでしっかりと押し込みます。ゴールドタイト・スクリュー (IUNIHG) を挿入し、ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、手締めでインプラントに固定します。

 ヘクスを合わせながらクラウンをインプラント上に設置します。スクエア・ドライバー (PSQD0N, PSQD1N) を用いてゴールドタイト・スクエア・スクリュー (UNISG) を挿入します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

 X線像でクラウンが確実に接続されていることを確認してください。

6.  ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ (RASH3N, RASH8N) とトルク・レンチ (L-TIRW) を用いて、ゴールドタイト・スクリュー (IUNIHG) を 20Ncm で締結します。

 スクエア・ドライバー・チップ (RASQ3N, RASQ8N) とトルク・レンチ (L-TIRW) を用いて、ゴールドタイト・スクエア・スクリュー (UNISG) を 32-35Ncm で締結します。

7.  スクリューの頭部に保護材を置き、アクセス・ホールを仮充填用の適切な材料とコンポジットレジンで封鎖します。必要に応じて咬合の調整を行ってください。

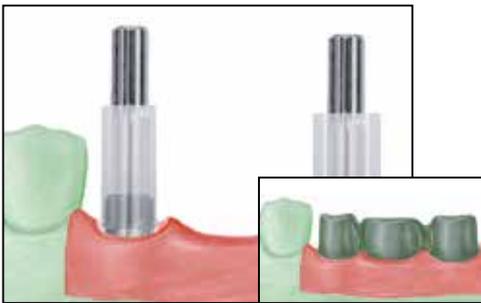
スクリューリテイニング

UCLAアバットメント 多数歯 間接法



歯科医師

1. インプラントレベルの印象を行うため、ピックアップ・タイプは 10-12 ページ、トランスファー・タイプは 13-15 ページを参照してください。



歯科技工士

2. 適切なサイズのノンヘラスト・UCLA アバットメントをアナログ上に設置します。

サーテン・チタン・ラージ・スクリュー (ILRGHT) またはワクシング・スクリュー (WSU30) を挿入し、ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて手締めで固定します。

トライイン・スクリュー (MUNITS, UNITS) またはワクシング・スクリュー (WSU30) を挿入し、ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて手締めで固定します。

必要に応じてプラスチックスリーブを削合、調整してください。メタル・フレームのワックスアップを行います。



3. トライイン・スクリューまたはワクシング・スクリューを取り外し、ワックスアップしたメタル・フレームをアナログから注意深く取り外します。埋没、焼却し、PFM フレームを鋳造します (8 ページ参照)。溶剤で埋没材を分離し、メタル・フレームを仕上げます。試適のためにメタル・フレームを歯科医に送ります。



歯科医師—スクリューを用いた試適

4. ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、ヒーリング・アバットメントを取り外します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。インプラントにメタル・フレームを試適します。最近心側のインプラントにスクリューを挿入し、ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて手締めで固定します。X線像でインプラント—アバットメント間の接続状態を確認します。メタル・フレームが完全に適合する場合には、インプラントとアバットメントのプラットフォーム間には隙間がありません。近心側に挿入したスクリューを抜去し、同じように遠心側のインプラントに挿入します。再度 X線撮影し、インプラントとメタル・フレームの接続状態を確認してください。仮に不適合がある場合には、フレームを口腔外で分離し、個々のパーツを再度インプラントに試適し、スクリューで固定します。常温重合レジンまたは石膏で個々のパーツを結合します。溶接するためにフレームを歯科技工士に送付します。結合されたフレームを再度試適し、適合を確認します。直ちにヒーリング・アバットメントをインプラントに装着します。

スクリーリテイニング

UCLAアバットメント 多数歯 間接法 (続き)



歯科技工士

5.  適合確認の済んだメタル・フレームを模型に戻し、トライイン・スクリーまたはワクシング・スクリーを手締めで挿入しアナログに接続します。陶材を築盛します。ポリッシング・プロテクターを付けて研磨します。



歯科医師

6.  ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、ヒーリング・アバットメントを取り外します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。
-  サーテン・ゴールドタイト・ラージ・スクリー (ILRGHG) を挿入し、ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて手締めで固定します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。
-  スクエア・ドライバー (PSQD0N, PSQD1N) を用いてゴールドタイト・スクエア・スクリー (UNISG) を挿入します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。
-  X線撮影により、補綴物とインプラントが確実に接続されているかを確認してください。
7.  ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ (RASH3N, RASH8N) とトルク・レンチ (L-TIRW を用いて、スクリーを 20Ncm で締結します。
-  スクエア・ドライバー・チップ (RASQ3N, RASQ8N) とトルク・レンチ (L-TIRW を用いて、スクリーを 32-35Ncm で締結します。
-  スクリューの頭部に保護材を置き、アクセス・ホールを仮充填用の適切な材料とコンポジットレジンで封鎖します。必要に応じて咬合の調整を行ってください。

スクリーリテイニング

ロー・プロファイル・アバットメント 単独歯 間接法

材料：

 チタン合金

適応：

- 単独歯または多数歯修復（スクリー・リテイニング）
- 必要なクリアランス 7.5mm 以上
- 必要な歯肉厚 1mm 以上
- 最大補正角度 30°
- エクスターナル 3.4mm (D) のアバットメントは、前歯部での使用に限る



歯科医師

1.  ヒーリング・アバットメントのエマージェンス・プロファイル (EP) 径とプラットフォームの直径に合わせてロー・プロファイル・アバットメントのサイズを選択します。アバットメントの角度 (0°、17°、30°) およびカラー部の高さを選択するため、頬側の軟組織から露出しているヒーリング・アバットメントの高さを計測します (ドーム状の隆起部は除く)。ヒーリング・アバットメントの高さから、この計測値を引き、その数値から更に 2mm 引くことで、ロー・プロファイル・アバットメントのカラー高を選択します。17 ページの補綴製品フローチャートを参照ください。



2.  ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、ヒーリング・アバットメントを取り外します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

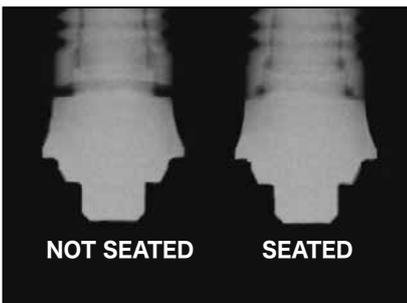


3.  クイックシート・アクチベーター・ツールを用いて、アバットメントのツメを ON にします (5 ページ参照)。ヘクスに合うようにアバットメントを挿入し、クリックの音と感触が得られるまでしっかりと押し込みます。

 ロー・プロファイル・アバットメントをインプラントのヘクスに合わせて装着します。

 ASYST ツールを摘みながら、ロー・プロファイル・アバットメント・スクリーをインプラントに挿入します。ASYST ツールを取り外します。

17°、30° の角度付きロー・プロファイル・アバットメントを使用して角度を補正する場合には、デリバリー・ツールを保持しながらインプラントへの接続角度を調節します。ドライバー・チップを用いてスクリーを手締めで締結します。



4.  X 線像でアバットメントとインプラントが確実に接続されているかを確認してください。フィルムはアバットメントとインプラントの接続面に対して垂直に配置します。

スクリーリテイニング

ロー・プロファイル・アバットメント 単独歯 間接法 (続き)



5.  **ストレート・アバットメント**: アバットメント・ドライバー・チップ (RASA3) と Low トルク・レンチ (L-TIRW) を用いて、アバットメント・スクリーを 20Ncm で締結します。

 **アングル・アバットメント**: ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ (RASH3N, RASH8N) と Low トルク・レンチ (L-TIRW) を用いて、アバットメント・スクリーを 20Ncm で締結します。

ロー・プロファイル・ヒーリング・キャップを装着する場合には、ラージ・ヘクス・ドライバーと Low トルク・レンチ (L-TIRW) を用いて 10Ncm で締結します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

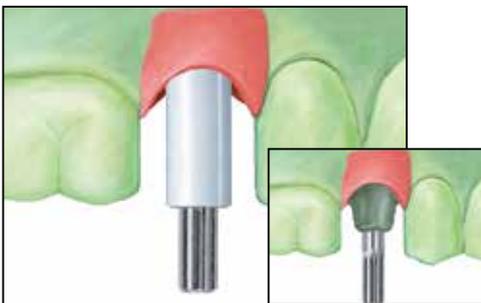
6.  **アバットメント・レベル**の印象を行うため、ピックアップ・タイプは 10-12 ページ、トランスファー・タイプは 13-15 ページを参照してください。

注意: ロー・プロファイル・アバットメントのインプレッション・コーピングにはツメがないため、アクチベートする必要はありません。



歯科技工士

7.  **ロー・プロファイル・ラボ**・アナログ上にヘクスト・ロー・プロファイル・ゴールドシリンダーを装着します。ロー・プロファイル・リテイニング・スクリー (LPCTSH) またはロー・プロファイル・ワクシング・スクリー (LPCWS) を挿入し、ラージ・ヘクスドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて手締めで固定します。必要に応じて、プラスチック・スリーブを削合してください。メタル・フレームのワックスアップを行います。



8.  **リテイニング・スクリー**または**ワクシング・スクリー**を取り外します。ワックスアップしたフレームを注意深くアナログから取り外し、埋没、焼却、鋳造します (8 ページ参照)。溶剤で埋没材を分離し、補綴物を仕上げます。



スクリーリテイニング

ロー・プロファイル・アバットメント 単独歯 間接法 (続き)



9.  模型内のアナログ上にメタル・フレームを戻し、ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、ロー・プロファイル・リテイニング・スクリュー (LPCTSH) またはロー・プロファイル・ワクシング・スクリュー (LPCWS) で固定します。メタル・フレームに陶材を築盛します。



歯科医師

10.  ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、ヒーリング・キャップを取り外します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。ヘクスを合わせながら、アバットメント上にクラウンを設置します。ラージ・ヘクス・ドライバーを用いて、ロー・プロファイル・リテイニング・スクリュー (LPCGSH) をアバットメントに挿入します。X線像でアバットメントとインプラントが確実に接続されているかを確認してください。隣在歯との接触、咬合を確認します。ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ (RASH3N, RASH8N) と Low トルク・レンチ (L-TIRW) を用いて、スクリューを 10Ncm で締結します。



11.  アクセス・ホールを仮充填用の適切な材料とコンポジットレジンで封鎖します。必要に応じて咬合の調整を行ってください。

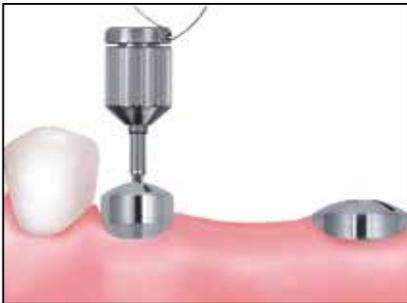
スクリーリテイニング

ロー・プロファイル・アバットメント 多数歯 間接法



歯科医師

1.  ヒーリング・アバットメントのエマージェンス・プロファイル (EP) 径とプラットフォームの直径に合わせてロー・プロファイル・アバットメントのサイズを選択します。アバットメントの角度 (0°、17°、30°) およびカラー部の高さを選択するため、頬側の軟組織から露出しているヒーリング・アバットメントの高さを計測します (ドーム状の隆起部は除く)。ヒーリング・アバットメントの高さから、この計測値を引き、その数値から更に 2mm 引くことで、ロー・プロファイル・アバットメントのカラー高を選択します。17 ページの補綴製品フローチャートを参照ください。



2.  ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、ヒーリング・アバットメントを取り外します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。

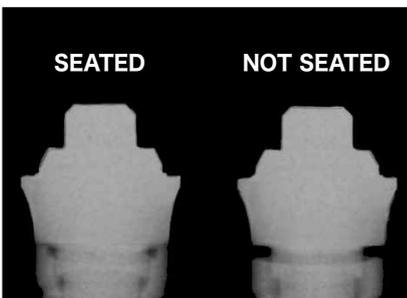


3.  クイックシート・アクチベーター・ツールを用いて、アバットメントのツメを ON にします (5 ページ参照)。ヘクスに合うようにアバットメントを挿入し、クリックの音と感触が得られるまでしっかりと押し込みます。

 ロー・プロファイル・アバットメントをインプラントのヘクスに合わせて装着します。

 ASYST ツールを掴みながら、ロー・プロファイル・アバットメント・スクリューをインプラントに挿入します。ASYST ツールを取り外します。

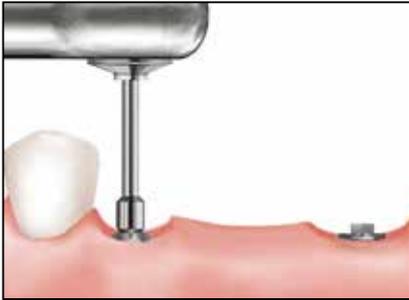
17°、30° の角度付きロー・プロファイル・アバットメントを使用して角度を補正する場合には、デリバリー・ツールを保持しながらインプラントへの接続角度を調節します。ドライバー・チップを用いてスクリューを手締めで締結します。



4.  X 線像でアバットメントとインプラントが確実に接続されているかを確認してください。フィルムはアバットメントとインプラントの接続面に対して垂直に配置します。

スクリーリテイニング

ロー・プロファイル・アバットメント 多数歯 間接法 (続き)



5. **ストレート・アバットメント**: アバットメント・ドライバー・チップ (RASA3) と Low トルク・レンチ (L-TIRW) を用いて、アバットメント・スクリューを 20Ncm で締結します。

アングル・アバットメント: ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ (RASH3N, RASH8N) と Low トルク・レンチ (L-TIRW) を用いて、アバットメント・スクリューを 20Ncm で締結します。

ロー・プロファイル・ヒーリング・キャップを装着する場合には、ラージ・ヘクス・ドライバーと Low トルク・レンチ (L-TIRW) を用いて 10Ncm で締結します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。



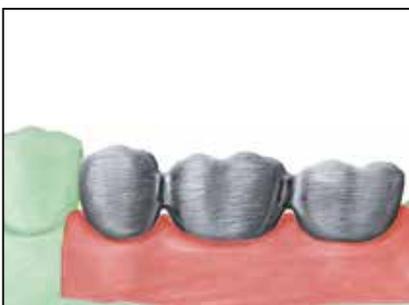
6. **アバットメント・レベル**の印象を行うため、ピックアップ・タイプは 10-12 ページ、トランスファー・タイプは 13-15 ページを参照してください。

注意: ロー・プロファイル・アバットメントのインプレッション・コーピングにはツメがないため、アクチベートする必要はありません。

歯科技工士



7. **ロー・プロファイル・ラボ・アナログ**上にノンヘクス・ロー・プロファイル・ゴールドシリンダーを装着します。ロー・プロファイル・リテイニング・スクリュー (LPCTSH) またはロー・プロファイル・ワクシング・スクリュー (LPCWS) を挿入し、ラージ・ヘクスドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて手締めで固定します。必要に応じて、プラスチック・スリーブを削合してください。メタル・フレームのワックスアップを行います。



8. **リテイニング・スクリュー**または**ワクシング・スクリュー**を取り外します。ワックスアップしたフレームを注意深くアナログから取り外し、埋没、焼却、鑄造します (8 ページ参照)。溶剤で埋没材を分離し、メタル・フレームを仕上げます。試適のために歯科医師に送付します。

スクリーリテイニング

ロー・プロファイル・アバットメント 多数歯 間接法 (続き)



歯科医師

9.  ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、ヒーリング・アバットメントを取り外します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。インプラントにメタル・フレームを試適します。最遠心側のインプラントにロー・プロファイル・リテイニング・スクリュー (LPCGSH) を挿入し、ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて手締めで固定します。X線像でインプラントーアバットメント間の接続状態を確認します。遠心側に挿入したスクリューを抜去し、同じように近心側のインプラントに挿入します。再度X線撮影し、インプラントとメタル・フレームの接続状態を確認してください。仮に不適合がある場合には、フレームを口腔外で分離し、インデックスを作製します。結合または溶接するためにフレームを歯科技工士に送付してください。結合されたフレームを再度試適し、適合を確認します。X線像でインプラントーアバットメント間の接続状態を改めて確認してください。確認後は直ちにヒーリング・アバットメントをインプラントに装着します。



歯科技工士

10.  適合確認の済んだメタル・フレームを模型に戻し、ロー・プロファイル・リテイニング・スクリュー (IPCTSH) またはロー・プロファイル・ワクシング・スクリュー (LPCWS) を手締めで挿入しアナログに接続します。陶材を築盛します。



歯科医師

11.  ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、ヒーリング・キャップを取り外します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。アバットメントに補綴物を設置します。ロー・プロファイル・リテイニング・スクリュー (LPCGSH) を挿入し、ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて手締めで固定します。X線像で適合状態を確認します。隣在歯との接触、咬合を確認してください。ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ (RASH3N, RASH8N) とLowトルク・レンチ (L-TIRW) を用いて、スクリューを10Ncmで締結します。アクセス・ホールを仮充填用の適切な材料とコンポジットレジンで封鎖します。必要に応じて咬合の調整を行ってください。

固定式補綴へのデンチャー コンバージョン

クイックブリッジ・プロビジョナル・コンポーネント - 直接法



歯科医師

1.  アバットメントの装着の前に、既存のデンチャーを用いて中心咬合位で咬合採得します。

特記：咬合面をワンピースで記録（1つのU型の記録）することは、左右それぞれに記録した咬合面を用いるよりも扱いが容易になります。左右または上下に分割された咬合面の記録を一つに合わせて使用することができますが、ワンピース型はより容易に口腔内で正確に調整することができます。



2.  アバットメント・ドライバー・チップ(RASA3)とLowトルク・レンチ(L-TIRW)を用いて、ロー・プロファイル・アバットメントを20Ncmで締結します。クイックブリッジのチタン・シリンダーを各アバットメントに設置し、ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて手締めで固定します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ (RASH3N, RASH8N) とLowトルク・レンチ (L-TIRW) を用いて、シリンダー・スクリューを10Ncmで締結します。デンチャーの裏面に早期硬化タイプの印象材を注入して口腔内に入れ、シリンダーの位置を写し取るために軽く押さえます。印象材の操作方法については、製造業者の指示に従ってください。この間、患者には中心咬合位を維持させてください。正中線は、顔の正中線と一致すべきであり、咬合平面を水平に保ちます。



3.  口腔内からデンチャーを取り外します。シリンダーの位置が印象材に写し取られています。印象材に写し取られた刻み目を参考にしながら、大きめのラウンドパーを用いて義歯床および人工歯を貫通させながらホールを形成します。デンチャーを口腔内で設置する際に、クイックブリッジのコンポーネントが義歯床と干渉しないように、パーを用いてホールを形成します。咬合の垂直的な変化がないことを確認します。

固定式補綴へのデンチャー コンバージョン

クイックブリッジ・プロビジョナル・コンポーネント – 直接法（続き）



4.  クイックブリッジのチタン・シリンダー上にクイックブリッジ・キャップをセットします。デンチャーを試適し、クイックブリッジ・キャップがデンチャーに干渉しないことを確認してください。クイックブリッジ・キャップの維持部分とリリース部に常温重合レジン塗布します。デンチャーをクイックブリッジ・キャップ上に装着し、咬合記録を用いて中心咬合位で軽く噛み合わせます。デンチャーが確実に設置され、咬合の垂直的な変化がないことを確認します。レジンの操作方法は、製造業者の指示に従ってください。上顎の正中線が顔の正中線と一致するようにしてください。

特記：インプラント埋入直後にこの作業を行い、即時咬合荷重をする場合には、アクリル・レジンでデンチャーを固定する前に、ラバー・ダムを加工してクイックブリッジ・チタン・シリンダーの周囲に設置してください。



5.  デンチャーを口腔内から取り外します。クイックブリッジ・キャップがデンチャー内に取り込まれています。バーを用いて、デンチャーから余剰レジンを取り除きます。クイックブリッジ・キャップ周囲の空隙には常温重合レジン塗布します。クイックブリッジ・チタン・シリンダーとクイックブリッジ・キャップを確実に接続するために、キャップ内にレジンが流れないように注意してください。デンチャーを研磨して完成させます。クイックブリッジ・キャップ内に少量の仮着用セメントを塗布し、暫間補綴物をクイックブリッジ・チタン・シリンダー上に設置します。中心咬合位で軽く噛み合わせを指示します。それぞれのキャップ周囲の余剰セメントを取り除きます。セメントの取り扱い方法は、製造業者の指示に従ってください。必要に応じて咬合調整をしてください。

固定式補綴のためのプロビジョナル作製

クイックブリッジ・プロビジョナル・レストレーション – 間接法



歯科医師

1.  患者使用中のデンチャーと対合歯を印象採得します。ポリビニル・シロキサン印象材を用いて咬合採得をします。



歯科技工士

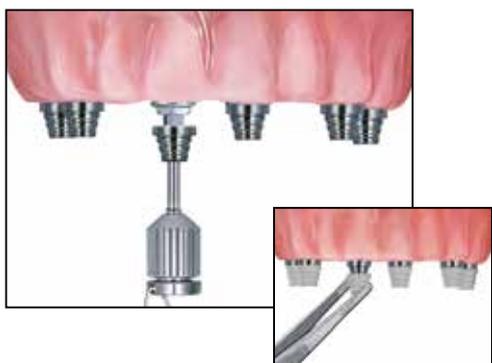
2.  石膏模型を製作します。採得した咬合の記録をもとに模型を咬合器に装着します。

3.  石膏模型を用いて、バキューム・フォームド・テンプレートを作成します。2mm厚のハードタイプのバキューム・フォーム用の材料を用いることを推奨します。模型からテンプレートを取り外し、余分な材料を切り取ります。テンプレート上のバリ等を取り除きます。咬合器を用いて対合歯とテンプレート間で咬合採得します。



歯科医師

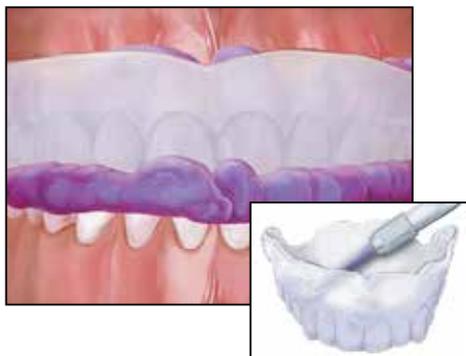
4.  バキューム・フォームド・テンプレートの歯列部分に印象材を注入し、口腔内のロー・プロファイル・アバットメント上に設置します。咬合の記録をもとに軽く噛み合わせて印象材をセットします。テンプレートから印象材を取り外します。印象材で製作した歯列の複製を口腔内に置き、咬合と歯列の位置を確認します。最終補綴物を製作する際、技工士が参考にするために、歯列の複製を保管しておきます。



5.  アバットメント・ドライバー・チップ(RASA3)とLowトルク・レンチ(L-TIRW)を用いて、ロー・プロファイル・アバットメントを20Ncmで締結します。クイックブリッジのチタン・シリンダーを各アバットメントに設置し、ラージ・ヘクス・ドライバー(PHD02N, PHD03N)を用いて手締めで固定します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ(RASH3N, RASH8N)とLowトルク・レンチ(L-TIRW)を用いて、シリンダー・スクリューを10Ncmで締結します。クイックブリッジのチタン・シリンダー上にクイックブリッジ・キャップをセットします。

固定式補綴のためのプロビジョナル作製

クイックブリッジ・プロビジョナル・レストレーション – 間接法（続き）



6.  常温重合レジンテンプレート内の歯列部分、クイックブリッジ・キャップの取り込まれる部分に注入します。口腔内のクイックブリッジ上にテンプレートを設置し、咬合の記録をもとに軽く噛み合わせします。レジンの操作方法は、製造業者の指示に従ってください。

注意：重合中は注水をしてください。レジンの設置中および重合中の発熱には十分に注意してください。



7.  口腔内からテンプレートを取り出します。キャップがレジン内に取り込まれます。キャップとシリンドーの接続を確実にするため、キャップ内にレジンが流れないように十分に注意してください。テンプレートからプロビジョナル・レストレーションを取り外し、マージン周囲の余分なレジンを取り除くと共に、空隙を埋めます。形状を調整、研磨してプロビジョナル・レストレーションを仕上げます。



8.  プロビジョナル・レストレーションを口腔内に移し、キャップとシリンドーが合うように仮設置します。適合性や審美性を確認します。必要な咬合調整を行ってください。プロビジョナル・レストレーションを取り外します。キャップ内に少量の仮着用セメントを塗布し、シリンドーに固定します。各キャップのマージン周囲の余剰なセメントを取り除きます。セメントの取り扱い方法は、製造業者の指示に従ってください。必要に応じて咬合調整をしてください。

特記：インプラント埋入直後にこの作業を行い、即時咬合荷重をする場合には、ラバー・ダムを加工してシリンドーの周囲に設置してください。

ボーン・アンカード・ブリッジ

UCLA アバットメント



歯科医師

1.   印象を行うためピックアップ・タイプは 10-12 ページ、トランスファー・タイプは 13-15 ページを参照してください。



歯科技工士

2.   ノンヘクスト・ゴールド・UCLA アバットメントまたはノンヘクスト・キャストアプル・UCLA アバットメントをインプラント・アナログ上に設置します。トライイン・スクリュー (MUNITS, ILRGHT, UNITS) またはワクシング・スクリュー (IWSU30, WSU30) を挿入し、ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて手締めで固定します。低膨張の光重合コンポジット・レジンまたは常温重合レジンを用いて、プラスチック・スリーブを合着することによって、ペリフィケーション・インデックスを製作します。また、基礎床と咬合堤も製作します。



歯科医師

3.   ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、ヒーリング・アバットメントを取り外します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。咬合堤を口腔内に設置し、咬合記録を採得します。ペリフィケーション・インデックスをインプラントに設置します。トライイン・スクリュー (MUNITS, ILRGHT, UNITS) またはワクシング・スクリュー (IWSU30, WSU30) を片側の最遠心に位置する UCLA アバットメントに挿入し、手締めで締結します。X 線像ですべてのインプラント上にシリンダーが確実に設置されているかを確認します。スクリューを取り外し、反対側の最遠心の UCLA アバットメントに挿入し、再度 X 線像で確認します。仮に不適合が見つかった場合には、インデックスを切断し、口腔内で再度合着してください。インデックスを取り外します。その後は、直ちにヒーリング・アバットメントをインプラントに装着します。



歯科技工士

4.   ペリフィケーション・インデックスを用いて、模型上に設置したアナログポジションが正確であるかを確認します。咬合記録を用いて、模型を咬合器に付着します。基礎床に人工歯を排列し、試適のためにワックスアップを行います。ペリフィケーション・インデックスが修正された場合は、模型内の不正確なアナログを特定するために使用します。特定された不正確なアナログを模型から取り外し、ペリフィケーション・インデックスに接続します。模型上に残されたアナログにインデックスを接続します。再挿入されたアナログが模型に接触していないことを確認してください。模型にアナログを再設置するために、超硬石膏を注入します。

ボーン・アンカード・ブリッジ

UCLA アバットメント (続き)



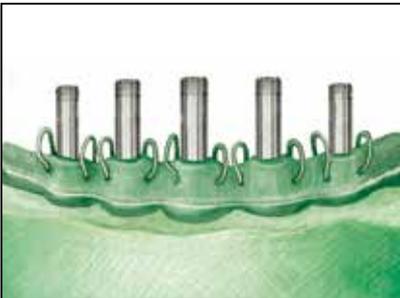
歯科医師

5.  ワックス・デンチャーを口腔内で試適します。咬合、審美および発音について確認します。必要に応じて調整を行います。大がかりな修正が必要な場合には新たに咬合記録を採得し、技工所にて再調整の後に再度試適を行います。

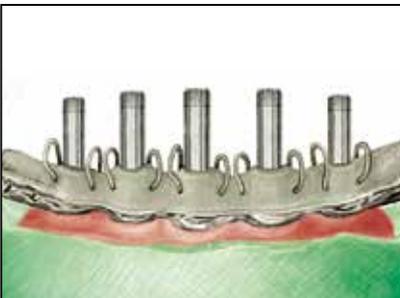


歯科技工士

6.  試適の確認を終えたワックス・デンチャーからコアを作成し、人工歯を取り込みます。通法に従い、フレームワークを製作します。



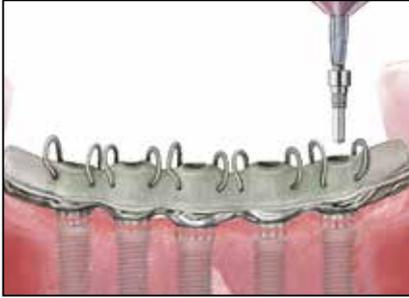
7.  ベリフィケーション・インデックスから UCLA アバットメントを注意深く取り外します。インプラント・アナログ上にノンヘクスト UCLA アバットメントを設置します。トライイン・スクリュー (MUNITS, ILRGHT, UNITS) またはワクシング・スクリュー (IWSU30, WSU30) を挿入し、ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて手締めで固定します。必要に応じてプラスチック・スリーブを削合します。ワクシング・スリーブにバー・パターンのワックスアップを行い、ワックスパターンの表面上にループもしくはアクリル維持のための形態を付与します。ワックス・デンチャーの範囲内でバーの位置を決めるために、模型上でシリコンコアを用います。



8.  ハイブリッド・バーのワックス・パターンを模型から取り外し、埋没、焼却、鑄造します (8 ページ参照)。溶剤で埋没材を分離し、ポリッシングプロテクターを用いてバーが軟組織に接触する面を研磨します。試適のためにバーを歯科医師に送り、適合を確認します。

ボーン・アンカード・ブリッジ

UCLA アバットメント (続き)



歯科医師

9.  ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、ヒーリング・アバットメントを取り外します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。インプラント上にバーを設置します。最も遠心のインプラントにトライ・イン・スクリュー (MUNITS, ILRGHT, UNITS) を挿入します。X線像で全てのインプラント上にバーが確実に設置されているかを確認してください。スクリューを取り外し、反対側の最遠心のインプラントに挿入した後、X線像で再度適合を確認します。不適合が見つかった場合には、バーをカットし口腔内でインデックスを作成します。結合または溶接するためにフレームを歯科技工士に送付してください。その後は、直ちにヒーリング・アバットメントをインプラントに装着します。



歯科技工士

10.  ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、ワックスアップした補綴物をプラスチックに埋め込み、加熱します。プラスチックを開輪してください。レジンが使用される場所にバーをセットします。フレームワークと模型の間のアンダーカット部はすべてブロックアウトしてください。通法に従って補綴物を完成させます。研磨のプロセスではポリッシング・プロテクターを使用してください。



歯科医師

11.  ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、ヒーリング・アバットメントを取り外します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。インプラント上に補綴物を設置します。
-  サーテン・インターナル・コネクションの場合は、ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N, PHD03N) を用いて、ゴールドタイト・ヘクス・ラージ・ダイアメーター・スクリュー (ILRGHG) を手回しで挿入します。
-  エクスターナル・コネクションの場合には、スクエア・ドライバー (PSQD0N, PSQD1N) を用いて、ゴールドタイト・スクエア・ユニスクリュー (UNISG) を手回しで挿入します。
-  X線像で適合を確認してください。適切なドライバー・チップと Low トルク・レンチ (L-TIRW) を用いて、サーテン・インターナル・コネクションの場合は 20Ncm、エクスターナル・コネクションの場合には 32-35Ncm で締結します。アクセス・ホールに適切な保護材を置き、レジンで封鎖します。補綴物のメンテナンスと口腔衛生について指導してください。

ボーン・アンカード・ブリッジ

ロー・プロファイル・アバットメント



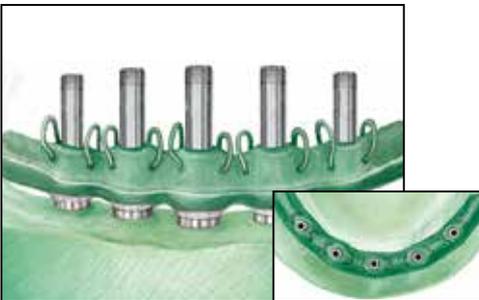
歯科医師

1.  印象を行うためピックアップ・タイプは 10-12 ページ、トランスファー・タイプは 13-15 ページを参照してください。

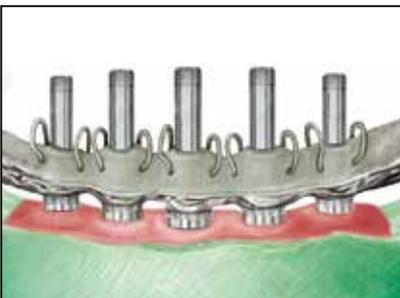


歯科技工士

2.  ベリフィケーション・インデックス、基礎床、咬合堤を製作、試適しシリコンコアを採得します (57, 58 ページ参照)。



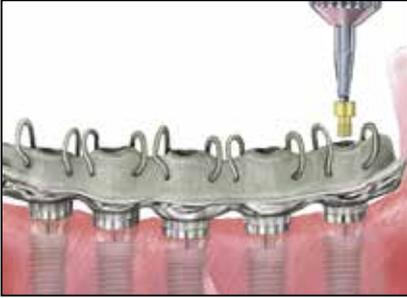
3.  ベリフィケーション・インデックスからロー・プロファイル・ゴールド・シリンドーを注意深く取り外します。シリンドーをアナログ上に設置し、ラージ・ヘクス・ドライバー (PHD02N または PHD03N) を用いてロー・プロファイル・ワクシング・スクリュー (LPCWS) で固定します。必要に応じてスリーブの高さを調整します。ワクシング・スリーブにバー・パターンのワックスアップを行い、ワックスパターンの表面上にループもしくはアクリル維持のための形態を付与します。ワックスデンチャーの範囲内でバーの位置を決めるために、模型上でシリコンコアを用います。



4.  ハイブリッド・バーのワックス・パターンを模型から取り外し、埋没、焼却、鑄造します (8 ページ参照)。溶剤で埋没材を分離し、ポリッシングプロテクターを用いてバーが軟組織に接触する面を研磨します。試適のためにバーを歯科医師に送り、適合を確認します。

ボーン・アンカード・ブリッジ

ロー・プロファイル・アバットメント（続き）



歯科医師

5.  ラージ・ヘクス・ドライバー（PHD02N, PHD03N）を用いて、ヒーリング・アバットメントを取り外します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。アバットメントにバーを設置します。ラージ・ヘクス・ドライバーを用いて、最も遠心のシリンダーにロー・プロファイル・リテイニング・スクリュー（LPCGSH）を手締めで挿入します。全てのインプラント上にバーが確実に設置されているかを確認してください。スクリューを取り外し、反対側の最遠心のシリンダーに挿入します。不適合が見つかった場合には、バーをカットし、口腔内でインデックスを作成します。結合または溶接するためにフレームを歯科技工士に送付してください。その後は、直ちにヒーリング・アバットメントをインプラントに装着します。



歯科技工士

6.  ラージ・ヘクス・ドライバー（PHD02N, PHD03N）を用いて、ワックスアップ・スクリューでバーをロー・プロファイル・アナログに接続します。模型上のバーにコアから人工歯を排列し、補綴物の製作を進めます。ワックスアップした補綴物をフラスコに埋没し、加熱します。フラスコを開輪してください。レジンが使用される場所にバーをセットします。フレームワークと模型の間のアンダーカット部はすべてブロックアウトしてください。通法に従って補綴物を完成させます。研磨のプロセスではポリッシング・プロテクターを使用してください。

特記：最適な結果を得るために、ワックスアップしたフレームワークを試適するためのアポイントメントの必要性を考慮してください。



歯科医師

7.  ラージ・ヘクス・ドライバー（PHD02N, PHD03N）を用いて、ヒーリング・アバットメントを取り外します。誤飲をさけるため、ドライバーの穴に糸を通しておきます。アバットメント上に補綴物を設置します。ロー・プロファイル・リテイニング・スクリュー（LPCGSH）を用いてロー・プロファイル・アバットメントに固定し、適合を確認します。必要に応じて咬合の調整、取り外して研磨を行ってください。ラージ・ヘクス・ドライバー・チップ（RASH3N, RASH8N）とLowトルク・レンチ（L-TIRW）を用いて、スクリューを10Ncmで締結し、補綴物を固定します。アクセス・ホールに適切な保護材を置き、レジンで封鎖します。補綴物のメンテナンスと口腔衛生について指導してください。

●製造販売元



ジンヴィ・ジャパン合同会社
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F
TEL. 0120-418-890 FAX. 0120-118-084